

# Business Report 2005

**FUJIMI**

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

## PROFILE

Fujimi Incorporated, since its founding in 1950, continues to chart a pioneering course as the first manufacturer of synthetic precision abrasives in Japan. Drawing on its precision grading technologies, accumulated experience and extensive research and development capabilities, the Company has expanded from abrasives for optical lenses to a variety of products that deliver the ultraprecise planarization sought by leading-edge high-tech industries.

Our lineup covers the complete spectrum from polishing abrasives for silicon wafers and other semiconductor substrates, to chemical mechanical planarization (CMP) products required for multilayered circuits on semiconductor chips, to abrasives for computer hard disks. We are cultivating new fields, commercializing such products as wire-saw slicing abrasives for solar cells, abrasives for quartz devices used in mobile telecommunications devices and, more recently, cermet (ceramic-metallic composite) thermal spray materials with dramatically improved impact resistance.

フジミインコーポレーテッドは、1950年の創業以来、精密分級技術などを活かした国産初の精密人造研磨材メーカーとして独自の歩みを続けてきました。蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基盤の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP(化学的機械的平坦化)、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面が求められる先端産業に欠かせぬものとなっています。また、太陽電池向けワイヤーソー砥粒や、移動体通信用水晶デバイス研磨などのほか、最近では耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材の商品化で新分野を開拓しています。

## CONTENTS

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT	1	社長あいさつ
FUJIMI'S BUSINESS AND PRODUCT CATEGORIES	2	フジミの事業とセグメント情報
FUJIMI'S MANAGEMENT DIRECTIONS	4	当社の経営方針
R&D AND ENGINEERING ACTIVITIES	6	研究開発活動
GLOBAL PRODUCTION AND SALES NETWORKS	8	生産拠点および販売拠点
PRINCIPAL PRODUCTS	10	主要製品
MARKET REVIEW	11	市場動向
FINANCIAL REVIEW (Consolidated)	14	財務レビュー(連結)
SELECTED FINANCIAL DATA (Consolidated)	16	経営指標(連結)
FINANCIAL STATEMENTS	20	財務諸表
STOCK INFORMATION	27	株式情報
CORPORATE DATA	29	会社データ



Akira Koshiyama  
President

代表取締役社長  
越山 彰

In fiscal 2005, ended March 31, 2005, the market for semiconductors was robust, owing to the expanding markets for personal computers (PCs) and other digital products. Fujimi recorded substantially improved sales of abrasives for silicon wafers, particularly polishing compounds, and lapping abrasives for the wire-saw slicing of silicon for semiconductors and solar cells. Sales of CMP polishing compounds used to facilitate multilayered wiring processes expanded steadily, as levels of semiconductor integration continued to rise at an even faster pace.

We also enjoyed firm sales of abrasives for hard disks, owing to higher total PC shipments—the result of stronger notebook PC sales—and the growing popularity of HDD (Hard Disk Drive) Recorders and portable digital audio players.

Thermal spray materials sales improved sharply, reflecting the wider use of ceramic thermal spray materials and cermet, a composite utilizing sophisticated powder technology to ensure maximum resistance to heat, friction and impact.

Our quartz lapping abrasives are mostly used in the slicing and polishing of quartz blanks for quartz devices inside mobile phones and digital cameras. Sales of these abrasives weakened as a consequence of falling prices and cheap Chinese imports.

For the past three years our corporate slogan has been “Rise to the challenge of innovation.” Every Fujimi division has made concerted efforts to utilize problem-solving approaches in line with this goal. As a result, we have made a certain amount of progress in terms of boosting sales and profits. A deeper analysis, however, reveals that this was partly attributable to more favorable business conditions and that we have still not reached our true potential. We have formulated a new slogan to guide us in rebuilding Fujimi’s competitive advantage as part of the goals of our medium-term vision: “Action, growth and dynamic progress.”

With a firm focus on the future, we have declared well-defined strategies and a clear corporate vision, which are being impressed upon every member of Fujimi, from management to individual employees. We have also introduced Balanced Score Card, a new management tool that will encourage forward-looking approaches and thereby bring us closer to the ideals and specific goals outlined in our vision and our strategies.

In the course of our business, Fujimi will strive to remain a good corporate citizen and maintain the trust of a broad spectrum of stakeholders.

In this and all our efforts, we ask for your continued support and understanding.

Akira Koshiyama  
President

2005年3月期における半導体市場は、パソコンや携帯電話、デジタル関連製品の市場拡大により総じて好調に推移しました。

当社のシリコンウェハー向け製品は、特にポリシング材が前期に比べ大幅に増加、半導体および太陽電池用シリコンの切断に使用されるワイヤソー向け製品の売上も大きな伸びを示しました。また、半導体の高集積化が加速する中、多層配線プロセスに用いられるCMP(化学的機械的平坦化)向け製品も順調に拡大しました。

ハードディスク市場は、ノートパソコンの好調な伸びによりパソコン全体の出荷台数が前年を上回り、またハードディスク搭載型のDVD録画再生機や携帯音楽端末の普及が進んだことから、ハードディスク向け製品の売上高は概ね順調に推移しました。

溶射材については、高度な粉末加工技術を活かした、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れた性能を持つサーメット溶射材に加え、セラミック溶射材の採用が進んだことにより、売上高は急増しました。

一方、水晶向け製品は主に携帯電話やデジタルカメラなどに組み込まれる水晶部品の切断や研磨用に使われていますが、単価下落や安価な中国品の影響を受け売上高は減少しました。

当社は過去3年間、「革新への挑戦」を年度スローガンに掲げ、各部門がビジョン達成のために果敢に問題解決に取り組み、活動してまいりました。その成果は、売上と利益の両面で一定の前進を図ることができましたが、中身を分析すると事業環境が好転したことに起因する業績達成であり、まだまだ本当の実力が備わっていないことを痛感しました。そのような中で、今年、私どもは中期ビジョン達成に向けフジミの強さを再構築する決意として、新しいスローガン「実行、成長、飛躍」を掲げました。

そして、企業経営の将来をしっかりと見据えて、ビジョン(将来に対する企業の挑戦的な目標)と戦略(課題・対策)を明確に掲げ、それらを経営トップから従業員一人ひとりに至るまで浸透させ、我々の夢であり目標であるビジョンと戦略の実現に向けて前向きに挑戦させる新しい経営改革手法『バランス・スコアカード』を導入しました。我々は全社を挙げて仕事に取り組み、幅広いステークホルダー(利害関係者)から信頼され、社会的責任を全うする企業になるよう努めてまいります。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長  
越山 彰

# FUJIMI'S BUSINESS AND PRODUCT CATEGORIES フジミの事業とセグメント情報

## Lapping Abrasives for Wire-Saw Slicing and Quartz Devices, Thermal Spray Materials and Others

Fujimi's abrasive powders for wire-saw slicing are used during the slicing of single-crystal ingots into wafers less than one millimeter thick—an essential part of the semiconductor manufacturing process. Our wire-saw slicing abrasives are also used in the production of solar cells for solar panels and solar-powered calculators. Recently, manufacturers have utilized these products for the lapping of quartz devices, which are used as frequency control and selection components in everyday items such as mobile phones, digital cameras and personal digital assistants (PDAs).

Thermal spray materials provide coatings that are highly impact-resistant, heat-resistant, anti-abrasive and anti-corrosive. Applications include construction machinery parts, boilers, rollers and large screws for ships. We also expect greater use of thermal spray materials by the electronics and semiconductor industries.

The Others product category includes polishing compounds for optical lenses and glass disks, abrasive cloth and paper, fine grinding machines and catalyst carriers.

## ワイヤーソー用、水晶デバイス用、溶射材、その他用途

ワイヤーソー用砥粒は、単結晶化させたシリコンインゴットを厚さ1ミリ以下のウェハーに切断する際に用いられ、半導体製造プロセスにはなくてはならないものです。また、太陽光発電パネルや電子計算機に埋め込まれている太陽電池の切断にも使われます。昨今、日常生活にあふれている携帯電話やデジタルカメラ、情報端末機器などの周波数制御・選択用電子部品としての水晶デバイス(水晶振動子)の研磨にも使われます。

また、溶射材は耐衝撃性・耐熱性・耐摩耗性・耐食性などを高めるためのコーティング材として建設機械部品やボイラー、圧延ローラー、船の大型スクリューなどに使われ、電子・半導体分野への用途拡大も期待されています。

その他の用途として、光学レンズ用、ガラス研磨用、研磨布紙、研削砥石、触媒担体などがあります。

## Polishing Compounds for Hard Disks

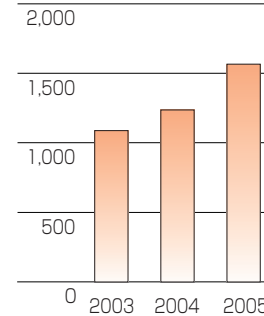
Hard disks are the magnetic disks in hard disk drives, the memory storage devices built into nearly all current PCs. Large memory hard disks that are able to read and store programs and data quickly are becoming more common, as technological innovation leads to even higher-performance PCs. The standard size of a hard disk is 3.5 inches, but manufacturers are increasingly using 2.5-inch disks for notebook PCs and 1.8- or 1.0-inch drives for smaller digital devices. The disks, which are made from aluminum or glass, now require an even smoother surface than that of silicon wafers. The state-of-the-art polishing compounds produced and supplied by Fujimi are essential in the manufacture of hard disks.

## ハードディスク用

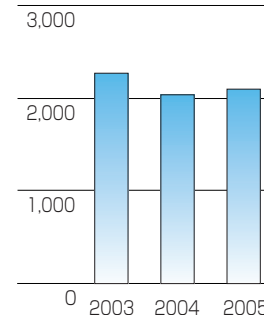
ハードディスクは円盤状の磁気ディスクで、現在ほとんどのパソコンに使われている記憶装置です。技術革新によりパソコンの高機能化が進み、プログラムやデータの高速読み出し・大量保存できる大容量メモリのハードディスクの普及が進んでいます。サイズの主流は3.5インチですが、ノートパソコン向けに2.5インチ、より小型の情報機器向けに1.8インチや1.0インチ製品も増えています。素材はアルミニウムとガラスが用いられますが、今ではシリコンウェハーと同等以上の研磨水準が要求されています。フジミが生産・供給する研磨材はハードディスクの生産にも不可欠な存在です。



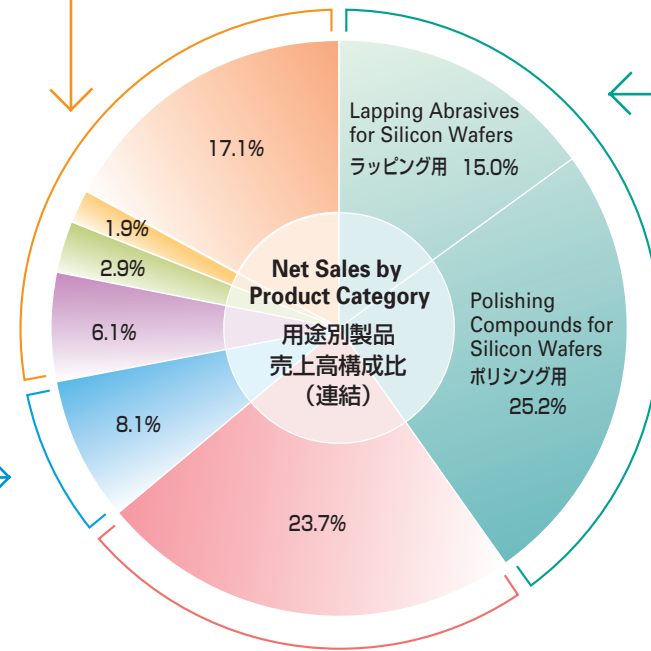
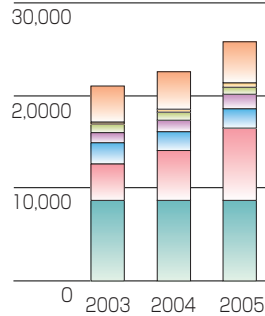
Sales of Lapping Abrasives for Wire-Saw Slicing  
ワイヤーソー用売上高  
(Millions of Yen) (百万円)



Sales of Polishing Compounds for Hard Disks  
ハードディスク用売上高  
(Millions of Yen) (百万円)



Sales of Others  
用途別製品売上高推移  
(Millions of Yen) (百万円)

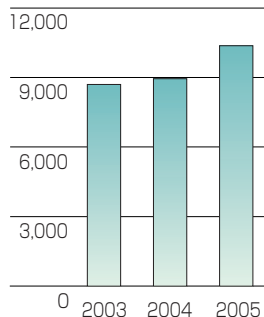


- Others/その他
- Thermal Spray Materials/溶射材
- Lapping Abrasives for Quartz Devices/水晶デバイス用
- Lapping Abrasives for Wire-Saw Slicing/ワイヤソー用
- Polishing Compounds for Hard Disks/ハードディスク用
- Polishing Compounds for CMP/CMP用
- Abrasives for Silicon Wafers/半導体ウェハー用

\* The graph does not include sales of machinery.  
 グラフには商品売上高は含まれておりません。



**Sales of Abrasives for Silicon Wafers**  
 半導体ウェハー用売上高  
 (Millions of Yen) (百万円)

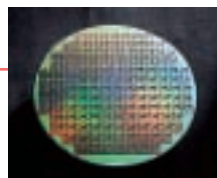


## Abrasives for Silicon Wafers

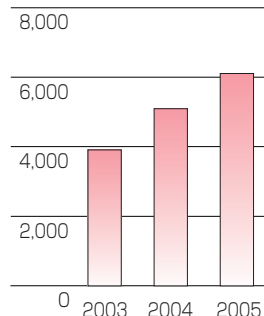
Semiconductors are the building blocks of an IT-based society. Their main application is in PCs, but they are also integral to mobile phones, audio-visual (AV) and office equipment, and millions of other products from the electronics industry. Semiconductors, which are mostly made of silicon, have a conductivity greater than insulators but less than conductors. A silicon wafer is a slice of an ultrapure silicon ingot. The wafer is between 0.3 and 0.8 millimeters thick and up to 300 millimeters in diameter. Advanced integrated circuits (ICs), known as large-scale integration (LSI) or ultralarge-scale integration (ULSI) devices are produced by etching electrical circuits onto the surface of the wafer. The silicon wafers are then diced into squares only a few millimeters across, to create semiconductor chips. Etching circuits onto silicon wafers requires technology that can guarantee a level of precision to the nearest millionth of a millimeter in achieving a smooth and level wafer surface finish. This is why semiconductors across the world rely on Fujimi's abrasives and polishing technologies.

## 半導体ウェハー用

半導体はパソコンを中心に、携帯電話、AV製品やOA機器など、電子産業関連機器類に組み込まれており、IT社会の心臓部の役割を果たしています。半導体は電気を通す導体と電気を通さない絶縁体の中間の性質をもつ物質で、シリコンはその代表的なものです。“シリコンウェハー”は高純度シリコンのインゴット(鑄塊)をスライスしたもので、厚さ0.3~0.8ミリ、直径は、最大で12インチの円盤です。その表面に電子回路を焼き付け、LSI、超LSIと呼ばれる最先端の半導体集積回路(IC)が作られます。そして、シリコンウェハーを数ミリ角に切断して半導体チップが作られるのです。シリコンウェハーに電子回路を焼き付けるためには、その表面を100万分の1ミリ単位の精度で平坦かつ滑らかにする技術が必要となります。そこで使用されるフジミの研磨材・研磨技術は世界中の半導体製造メーカーから高い信頼を得ています。



**Sales of Polishing Compounds for CMP**  
 CMP用売上高  
 (Millions of Yen) (百万円)



## Polishing Compounds for CMP

IC chips that are only a few millimeters in size contain over one million semiconductor devices. To minimize the size of such high-performance, high-integration LSIs, manufacturers use multilayered wiring technology, to overlay several electric circuits with intervals of less than one micrometer ( $\mu\text{m}$ ) (one thousandth of a millimeter). Imperfections on the IC surface around wiring materials would lead to flaws in the insulation between wiring layers making it impossible to create highly intricate wiring structures. CMP is a polishing process that removes surface imperfections to achieve extremely flat surfaces. The process utilizes mechanical polishing with abrasive powders and chemical polishing. Our shipments of CMP slurries to domestic and overseas manufacturers continue to increase steadily, reflecting the need for more highly integrated semiconductors with multilayered wiring and the outstanding quality of our product.

## CMP用

わずか数ミリのICチップに100万個以上の半導体素子が組み込まれていますが、こうした高性能、高集積LSIをできるだけ小さいチップサイズで実現するために、チップ上には1マイクロメートル( $\mu\text{m}$ 、 $1\mu\text{m}=1000$ 分の1mm)以下の間隔で施された微細な電子回路が、多層配線(垂直方向に配線を複数積み重ねた立体的な配線構造)という技術を用いて何層にも積み重ねられます。多層配線では、IC表面に配線などの凹凸段差があると配線層間で絶縁不良などが生じ、微細配線構造が形成できなくなります。そのために表面上の凹凸をなくし、平坦化する技術がCMP(Cheical Mechanical Planarizationの略)で、砥粒を用いた機械的研磨とケミカル剤による化学作用を複合させたポリシング(鏡面研磨)加工を言います。半導体デバイスもさらなる高集積化・多層配線化が要求され、CMPスラリー(研磨液)は、その優れた品質特性から国内外のデバイスメーカーへの出荷が順調に拡大しています。

Fujimi has positioned abrasives at the core of its business and aims to be a leading developer of powder technologies that support the evolution of advanced manufacturing processes. Our corporate mission, which guides our management strategies, is to respond with new technologies to the expectations of advanced industrial societies, and create a flexible and assertive corporate culture. In line with this mission, we have made unceasing efforts to ensure a stable supply of the highest-quality products.

As a company whose strengths lie in research and development (R&D), we are building an organization that will facilitate the creation of higher-quality products and maximize customer satisfaction. We believe that concerted efforts toward these goals will raise our corporate value.

We plan to remain at the vanguard of the global abrasives industry. To do so, we will enhance core technologies, as well as other leading-edge technologies, in line with our corporate slogan: "Polishing our technologies and bringing people together." Our advanced technological capabilities assist manufacturers to improve product quality and customer satisfaction, thereby linking us with manufacturers, final consumers and suppliers in a broad effort to enhance lifestyles worldwide.

### Medium-Term Strategies

We are targeting consolidated return on equity (ROE) of over 10% by fiscal 2007, the final year of our medium-term strategies. Another challenge is to build a truly global company in which every employee can take pride. All parts of the Fujimi Group must cooperate to promote key strategies and overcome fierce competition as the market continues to evolve at an increasingly faster pace.

In January 2004, we opened two sales subsidiaries in Europe to cultivate new markets and expand sales. We now have bases in Japan, the United States, Southeast Asia and Europe.

The Fujimi Group's key medium-term strategies include:

- Introducing shorter product-development cycles and accelerating product launches

- Pioneering new applications for existing products
- Utilizing environment-friendly manufacturing methods as part of efforts to improve corporate social responsibility (CSR)
- Cultivate new markets for our powder technologies by maximizing our creativity, flexibility and desire for new challenges
- Build a solid corporate foundation capable of weathering market fluctuations

We will continue to improve the efficiency of Group operations so that we may remain a true leader in the abrasives industry. For this purpose, we have adopted the Balanced Scorecard management system to promote achievable visions for our principal businesses and are pursuing strategic goals and strategies that will increase our competitiveness in the global market.

### Environmental Conservation

The operations of the Fujimi Group are closely tied to the lives and activities of a great number of people, including customers, shareholders, raw materials suppliers, local communities and employees. Our manufacturing processes exert a considerable environmental impact. We are therefore fully aware of the obligation to maintain a rich and sustainable environment for future generations.

We must tackle important challenges posed by global warming, diminishing natural resources, waste accumulation and chemical substance management. This requires management and employees to assess our environmental impact, find ways to minimize it and then make every effort to implement appropriate solutions. We will utilize management resources wisely to support such activities, giving full consideration to the cost-effectiveness of every investment.

In addition to educating our own staff about environmental concerns, we wish to explain our environment conservation activities to date, as well as our future plans, to those outside our organization. For this reason, we decided to publish an environmental report. With "environment-friendly manufacturing activities" as our watchword, we will strongly promote activities that reduce environmental impact.

### Code of Ethics

We take pride in our work and strive to fulfill our motto—"Fujimi—a company to trust"—by conducting business in a fair manner and adhering to a strict code of ethics. Directors and management understand the vital role they must play in achieving adherence to our code of ethics. To this end, they will lead by example, ensuring greater awareness of the code's importance. Should violations of the code occur, every employee will work to identify the causes of the infractions, resolve the issues and prevent recurrences.

#### Basic Mission

- Raise levels of customer satisfaction by offering outstanding quality
- Provide safe products and services that contribute to technological progress

#### Compliance with Laws and Protocol

- Comply with laws and protocols in Japan and overseas
- Respect all intellectual property rights while utilizing and protecting our own intellectual property

#### Respect for Human Rights

- Respect all cultures and customs
- Create safe and pleasant work environments that are free from discrimination on the basis of gender, race, nationality or religious belief, or from prejudice against individuals with disabilities

#### Reduction of Environmental Impact

- Remain fully aware of environmental issues
- Strive to conserve the environment by effectively using resources and helping to promote recycling

#### Disclosure

- Disclose corporate information in a fair and timely manner to shareholders and the general public
- Prevent misuse or leaking of personal or insider information

#### Fair and Proper Business Conduct

- Ensure fair and unrestricted competition within our industry
- Maintain transparent and healthy relations with business partners, affiliated organizations, and governmental and political institutions
- Ensure that no profits are channeled to groups or individuals that threaten the stability of democratic societies

## 経営の基本方針

当社は、その事業領域を“研磨技術を核として、産業界のハイテクフィールドを支えるパウダーテクノロジーのリーディング企業を目指すこと”に置いており、経営戦略の根幹をなす企業理念として、

『高度産業社会の期待に新技術で応える』

『柔軟でアグレッシブな企業づくりを目指す』

を掲げて、創業以来一貫して製品の高品質化と安定供給に努めてきました。

技術革新が急速に進む中、今後ますます変化のスピードが加速している事業環境にあって、研究開発型企業である当社は「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めていきます。

コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」を合言葉に、研究開発型企業である当社はコア技術をさらに高め、先端技術を磨くことにより世界をリードします。また、先端技術を通して顧客のより良い製品づくりに貢献し、さらに満足度と信頼を高めることでユーザー、最終製品消費者、仕入先、従業員等の心をつなぎ、世界の人々の生活を豊かにします。

## 中長期的な経営戦略

当社は、2007年3月期を最終年度として連結ベースでROE(株主資本当期純利益率)を10%以上とする中長期企業ビジョンを掲げており、この数値目標に加え「真にグローバルで社員一人一人が誇りを持つ企業」の構築を目指しています。

現在の市場環境は急速に変化を遂げており、熾烈な競争を勝ち抜くためにフジミグループが一体となって事業戦略を推進する必要があります。

昨年1月には、欧州市場での市場開拓と拡販を目的として欧州販売子会社2社が相次いで営業を開始し、日本、米国、東南アジア、欧州の世界4拠点体制が確立いたしました。

今後さらに子会社との連携強化を図り、海外における情報収集の機能を高め、顧客ニーズに迅速かつ的確に応えることのできるグローバルな体制強化に取

り組んでいきます。

中長期経営戦略としては、

- 新製品の開発サイクルの短縮化と迅速な市場投入を実現する。
- 既存製品の新規用途開拓を積極的に進める。
- 環境に配慮したモノづくりを徹底し、社会的責任を果たす。
- 創造性を発揮し、柔軟な思考とチャレンジ精神でパウダーテクノロジーの応用分野で新規市場を開拓する。
- 業界変化に左右されない筋肉質の企業体質を構築する。

以上の5項目を掲げています。

また、事業別の視点においては、バランス・スコアカードに基づき主要事業ごとに事業ビジョンを掲げており、戦略テーマを具体化した戦略目標と施策を着実に実行することで市場競争力を高め、真のリーディングカンパニーを目指し連結経営効率の向上に努めていきます。

## 環境への取り組み[未来への責任]

私たちは、お客様、株主、原材料調達先、地域住民、社員など、さまざまな人たちとの関わり合いの中で事業を営んでいます。その過程で少なからず環境に影響を与えており、この豊かな地球環境を永く後世に伝えていく責任を強く自覚しています。

当社は、地球温暖化問題、資源問題、ゴミ問題、化学物質管理を重要な企業課題として取り上げ、その環境負荷を低減するために何ができるか全社を挙げて考え、積極的な活動を続けるとともにどのような負荷を環境に与え、どのように減らすのか、費用対効果を充分検討しながら効率的・効果的な経営資源の投入を行っています。

私たちのこれまでの活動、そしてこれからの「環境」に対する私たちの思いを、社内だけでなく社外の多くの方にも理解してもらうため、『環境報告書』を創刊しました。

私たちは、“地球環境に優しいモノづくり”を合言葉に、環境負荷低減活動を積極的に推進していきます。

## 倫理綱領

われわれは、誇りを持って仕事に取り組み、倫理綱領を遵守し公正に行動することにより、「信頼のフジミ」であり続けます。

取締役および管理職社員は、倫理綱領の遵守が自らの重要な役割であることを認識し、率先垂範のうえ関係者に周知徹底します。倫理綱領に違反する事態が生じたときは企業を挙げて問題の解決に当たり、原因の究明と再発の防止に努めます。

### 1. 基本的使命

常に顧客満足度を高める質の創造に取り組み、安全で社会の発展に寄与する商品とサービスを提供する。

### 2. 法の遵守

国内外の、関係する条約・法令を遵守する。すべての知的財産を尊重し、自らの知的財産を保護・活用する。

### 3. 人権の尊重

グローバルな企業として異なる文化と慣習を尊重し、性別・人種・国籍・信条・障害等による差別の無い、安全で快適な環境を実現する。

### 4. 環境負荷の低減

環境問題の重要性を認識し、資源の有効活用、循環型社会の確立に取り組み、地球環境の保全に努める。

### 5. 企業情報の開示

株主はもとより、広く社会に対し企業情報の開示を公正かつタイムリーに行うとともに、業務上知り得た秘密情報を不正に使用せず、漏洩しない。

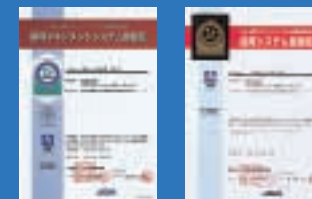
### 6. 公正な取引の維持

同業他社との公正で自由な競争、取引先・関係機関・政治・行政との健全で透明な関係を保ち、社会秩序に脅威を与える勢力に利益を供与しない。



Fujimi published *Kankyou Eco Hon*, its first environmental report, which provides a full outline of the Company's environment conservation activities. The report describes the environmental impact of our operations and conveys our views on environmental issues. Having taken this step, we will continue to promote environmental conservation and social contribution activities, and make every effort to ensure that our products cause no harm.

**環境報告書「環境絵コ本」を創刊**  
当社の環境への取り組みを今回初めて環境報告書としてまとめました。企業活動と地球環境との関係、私たちの環境に対する考え方や活動を伝えています。今後も環境保全活動、安全な商品の提供、社会貢献活動に努力していきます。



In 1994, ahead of its competitors, Fujimi obtained ISO 9002 for its plants in Japan and the United States. In 1999 and March 2000, respectively, Fujimi received ISO 9001 and ISO 14001 for its domestic plants. In March 2003, subsidiary Fujimi-Micro Technology Sdn. Bhd., in Malaysia, also obtained ISO 14001.

### 国際規格ISOを取得

フジミは、1994年に業界に先駆けて日米の全生産拠点で品質保証および品質管理の国際規格である「ISO 9002」の認証を取得。続いて、1999年には国内の全生産拠点で「ISO 9001」を、2000年には環境管理の国際規格である「ISO 14001」を取得しました。2003年3月にはアジアにおける製造販売拠点フジミマイクロテクノロジー(マレーシア)でも「ISO 14001」の認証を取得しました。

### R&D Themes

#### *Responding to higher integration in semiconductor devices*

In recent years, most corporations and many households have become connected to high-speed broadband communications networks. Digital consumer electronics incorporating very large-scale integration (VLSI) circuits are also becoming a regular feature of daily life. The range of applications for VLSI circuits is expected to expand from PCs to other fields, as devices with higher levels of integration are used for a wider variety of purposes. In addition, manufacturers are switching to the production of 300-millimeter wafers as shrinking design rules enable mass production of chips with linewidths measuring 65 nanometers.

Furthermore, wider wafer diameters, which increase productivity, and smaller chip linewidths have created a need for extremely precise and high-quality surface polishing processes. We are developing low-cost, environment-friendly primary polishing slurries and slurries that prevent metal contamination. At the same time, we are conducting research into new processing methods for dual-sided and single-head wafer polishing, as well as a wide range of other themes.

As part of our R&D efforts in the area of 300-millimeter wafers, we have installed CMP equipment suited to current manufacturing environments. We continue in our efforts to develop polishing technologies that produce flatter finishes with fewer defects and in support of this plan to install state-of-the-art wafer inspection systems during fiscal 2006. We are also applying our expertise

in final polishing materials for silicon wafers to the development of CMP slurries. Our exceptionally pure colloidal silica-based slurries—which are used in environments where even the smallest trace of metal ion could cause defects—have been received favorably for use in CMP processes for interlayer dielectric (ILD) and polysilicon materials, as well as next-generation circuitry materials combining copper with “low-k,” or low-dielectric-constant materials, for dual-damascene CMP processes. Seeking even stronger support from customers throughout the world, our research engineers work around-the-clock shifts to enable prompt responses to customers.

#### *Developing polishing compounds for faster hard disks with higher capacities*

Demand for hard disk drives has traditionally been determined by demand for PCs. In recent years, however, there has been a surge in demand for hard disk drives for use in digital consumer electronics, triggering further expansion of the market. Among such digital consumer electronics products, DVD Recorders and portable digital audio players are enjoying the sharpest rises in demand. As a result, manufacturers are constantly seeking disks with higher recording capacities, an improvement necessitating even flatter and more polished disk substrates. At Fujimi, we are working on developing the primary stage slurries and final polishing slurries for nickel-plated (NiP) substrates to satisfy the requirements for next-generation high-capacity disks. We are also focusing on research into lapping

materials and polishes for glass disks, mainly used in PCs and portable digital audio players.

#### *Venturing into thermal spray materials*

Thermal spray materials are composites that are heated and sprayed onto substrates to form coatings that provide greater protection against heat, friction and corrosion. The thermal spray particles have to be spherical and of a consistent diameter to make denser, higher-quality coatings. We will continue to capitalize on our milling and grading technologies that we have developed in the abrasives business to develop high-quality thermal spray materials—notably cermet, a ceramic-metallic composite—that are extremely resistant to heat, friction and corrosion.

We were the first in the world to design a system capable of spraying ultrafine ceramic particles in high-velocity oxy-fuel (HVOF) and high-velocity air-fuel (HVOF) thermal spray processes. We expect that this system, which delivers high-density coatings never before achieved, will find a number of important applications in the electronics and semiconductor fields. Another attractive feature of this system is that it drastically reduces surface imperfections, greatly reducing postspray polishing costs. This thermal spray technology has been heralded by many industries as an environment-friendly alternative to hard chrome plating, a source of toxic hexavalent chromium emissions.

## 研究開発テーマ

### 半導体デバイスの高集積化対応

ブロードバンドと呼ばれる高速通信ネットワークが、企業だけでなく一般家庭にまで普及する時代になりました。家電製品はデジタル家電と呼ばれ、心臓部である半導体デバイス(超LSI)は、一層生活の中に浸透しています。超LSIは、従来のパソコン用途からさまざまな分野で使用され、高集積化、多様化はますます進展していくと予想されます。

デザインルールをの微細化は、すでに65ナノメートル(nm)の量産が始まり、半導体ウェハーでは300mm化が進んでいます。大口径化によるさらなる生産性向上、微細化の高まりの中で、表面研磨には、極限まで高精度化・高品質化が求められています。当社は、環境に配慮した低コストでの一次研磨用スラリー、金属汚染防止タイプスラリーの開発、そして両面ポリシングや枚葉式ポリシング等の新しい加工法など、さまざまな研究テーマを掲げ問題解決に注力しています。

また300mmウェハー分野では、ユーザーの最新環境に合わせたCMP装置を導入し、さらに今年度は最新鋭の欠陥検査装置を導入する予定で、より平坦で欠陥の少ない研磨加工技術の開発に取り組んでいます。

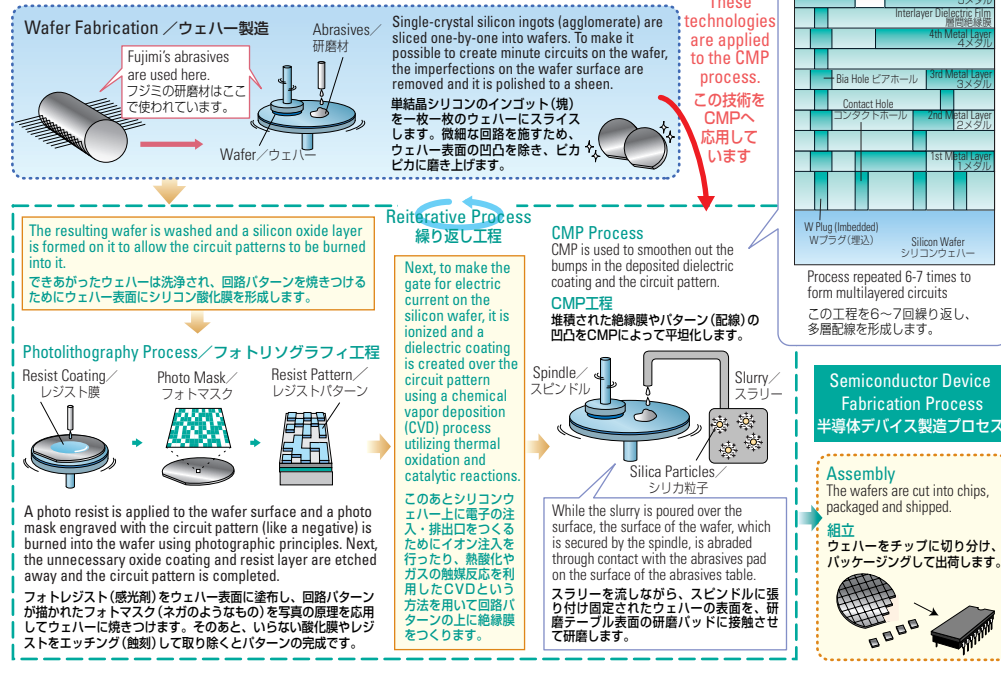
CMPは当社が長年シリコンウェハー用ファイナルポリシング材で培った技術・ノウハウを応用展開した分野です。ごく微量の金属イオンさえ欠陥原因となる環境下で、超高純度コロイダルシリカを原料にした当社のCMPスラリーは、ILD(層間絶縁膜)やPoly-Si(ポリシリコン)をはじめ次世代配線材料である銅(Cu)とLow-k膜(低誘電率)の組合せによるデュアルダマシンプリシング用として高い評価を得ています。

そして、世界中からより高い支持をいただくために、研究開発スタッフは24時間体制でユーザーからの声を聞いています。

### ハードディスクの大容量化・高速化対応

これまでハードディスクドライブはパソコン需要の伸びに連動して成長してきました。近年デジタル家

## Role of CMP Processes in Semiconductor Device Fabrication 半導体デバイス製造におけるCMPの役割



電製品への搭載は目覚しく、さらなる市場の拡大が見込まれます。特に、従来のビデオテープレコーダーに代わりハードディスク搭載のDVDレコーダーや携帯型の音楽プレーヤーなどが著しく伸びています。搭載ディスク1枚当たりの記憶容量向上要求はますます厳しくなり、ディスク基板の一層の平坦度化、高鏡面化が求められます。当社では、こうした次世代の高容量化に対応するNi-P用の一次研磨用スラリーやファイナルポリシングスラリー及びパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに搭載されるガラスディスク用のラッピング材、ポリシング材に注力し研究を進めています。

### 溶射材事業

溶射材とは、熱や摩耗、腐食などから守るため、素材の表面に熱で溶かしながらスプレーしてコーティングする被膜材料のこと。より緻密で品質の良い溶

射皮膜を作るには、粒が球形で、粒径が揃っていることが重要です。当社がこれまで研磨材分野で培ってきた粉砕や分級技術を生かし、当社では「サーメット」と呼ばれるセラミックスと金属との複合材料を中心に、耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性に優れた高品質な溶射材を独自開発しています。また、セラミックスの微粉末を高速フレーム溶射機(HVOF)で溶射できるシステムを世界で初めて開発し、従来では得られなかった高機能皮膜の形成が可能となり、電子・半導体分野への適用が期待されています。この被膜は極端に凹凸が少なく、溶射後の研磨コストが大幅に低減できるため、昨今の環境問題への配慮から六価クロム生成や廃液処理に課題の残る硬質クロムメッキの代替技術として、業界各方面からも注目されています。



Fujimi's stringent quality control system reflects the Company's commitment to raising customer satisfaction by ensuring outstanding quality and supply capabilities.

フジミは、「顧客満足を高める質の創造と提供」を品質方針に掲げ、徹底した品質管理を行っています。



To facilitate timely R&D on advanced themes, such as CMP, Fujimi has created a comprehensive R&D system and installed state-of-the-art equipment.

フジミではCMPをはじめ高度な技術開発ニーズにリアルタイムで応えるべく、最新鋭の設備を配し万全の開発体制を敷いています。

## GLOBAL PRODUCTION AND SALES NETWORKS 生産拠点および販売拠点

### Production and Sales Locations

The Fujimi Group currently maintains four production facilities in Japan, one in the United States and one in Malaysia. In Japan, we produce lapping abrasives for silicon wafers and polishing compounds for silicon wafer production, CMP and hard disk production at our Kakamigahara and Kakamihigashimachi plants, in Kakamigahara, Gifu Prefecture. Together, these two plants account for approximately 60% of the Fujimi Group's total output.

Our Central Plant, adjacent to our headquarters in Nishibiwajima-cho, Aichi Prefecture, manufactures abrasives for silicon wafers and quartz devices. The Inazawa Plant, in Inazawa, Aichi Prefecture, produces wire-saw slicing and glass lapping abrasives. The No. 2 Kakamihigashimachi Plant primarily produces cermet thermal spray materials that utilize powder technologies developed in the field of lapping abrasives.

The plant of subsidiary Fujimi-Micro Technology Sdn. Bhd., in Malaysia, is our production base for Southeast Asia. By supplying polishing slurries for hard disks to manufacturers operating in the local market, the plant has substantially

### 生産・販売体制

フジミは現在、国内4カ所、米国1カ所およびマレーシア1カ所に生産拠点を有し、国内の各務原工場、各務東町工場では半導体ウェハー用ラッピング材およびポリシング材、CMP用、ハードディスク用ポリシング材の主要製品をはじめ、グループ全体の6割以上の生産量を占めています。本社工場では半導体ウェハーおよび水晶デバイス用の研磨材を生産しています。稲沢工場では、ワイヤーソー切断用砥粒およびガラス用研磨材を主に生産、また各務東町工場第二棟では、研磨材で培ったパウダーテクノロジーを応用した「サーメット溶射材」を主に生産しています。さらにアセアン地域の生産拠点であるフジミマイクロテクノロジー（マレーシア）では、現地ユーザー向けにハードディスク用ポリシング材を生産しておりリードタイムの短縮が図られています。今後は、

reduced lead times. With greater use of hard disks in digital home electrical appliances, Southeast Asia will take on increasing importance as a production center for these products. To reinforce our position in the region, we will focus on launching competitive products and enhancing customer services.

In spring 2004, U.S. manufacturing subsidiary Fujimi Corporation built an R&D Center and added a special CMP polishing compound production line. This step was taken to facilitate more flexible development and production of CMP polishing compounds in response to a rapidly expanding global market.

By integrating development, manufacturing and marketing capabilities in this way, we intend to initiate a more effective foray into the North American market.

We also plan to expand European sales of products for semiconductor wafer and hard disk manufacturing as well as CMP processing. To this end, in January 2004, we commenced operations at our new sales subsidiaries, Fujimi Europe Limited, in Britain, and Fujimi Europe GmbH, in Germany.

ハードディスクのデジタル家電への搭載がさらに進むことから、アセアン地域の重要性はますます高くなると考えられます。当社はこの地区での優位性を確保するため、より競争力のある製品の市場投入と、きめの細かいサービスを提供してまいります。

さらに北米地域の生産拠点であるフジミコーポレーションでは、世界規模で市場が急拡大するCMPスラリーの開発と生産をより機動的に行うため、2004年春に新R&Dセンターの建設とCMPスラリー専用ラインの増設をしました。これにより、開発・製造・営業機能を一体化し、北米での拡販戦略を効率的に推進してまいります。2004年1月には、半導体ウェハー、ディスク、CMP向け製品の欧州地域での拡販を目的として、英国とドイツにそれぞれ販売子会社フジミヨーロッパを設立し、営業を展開しています。



Fujimi Corporation  
(Oregon, U.S.A.)  
フジミコーポレーション  
(米国 オレゴン州)



### FUJIMI CORPORATION フジミコーポレーション

#### Products manufactured

Lapping abrasives for silicon wafers  
Lapping abrasives for glass disks  
Polishing compounds for CMP

#### 生産品目

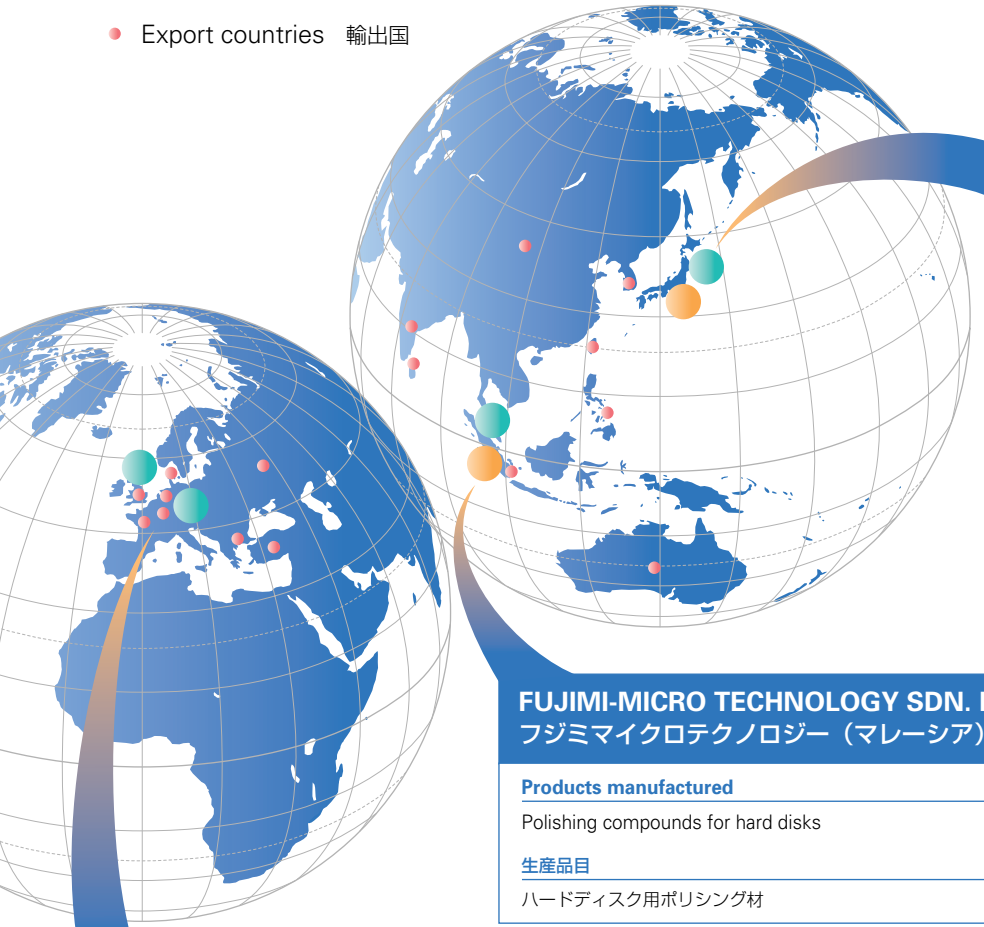
シリコンウェハー用ラッピング材  
ガラス用ラッピング材  
CMP用ポリシング材

### Consolidated Sales by Region Years ended March 31, 2004 and 2005

#### 地域別販売状況(連結)

Unit: Millions of yen 単位：百万円	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Asia, Oceania アジア、オセアニア	6,808	7,292
North America 北米	3,444	3,512
Europe 欧州	1,552	2,415
Japan 日本	12,133	13,888
Total 合計	23,938	27,109

- Sales offices 販売拠点
- Production facilities 生産拠点
- Export countries 輸出国



<b>FUJIMI INCORPORATED</b>	<b>フジミインコーポレーテッド</b>
<b>Central Plant (headquarters)</b> <b>Inazawa Plant</b> <b>Kakamigahara Plant</b> <b>Kakamihigashimachi Plant</b> <b>No. 2 Kakamihigashimachi Plant</b> <b>Tokyo Sales Office</b>	<b>本社工場</b> <b>稲沢工場</b> <b>各務原工場</b> <b>各務東町工場</b> <b>各務東町工場第二棟</b> <b>東京営業所</b>
<b>Products manufactured</b>	<b>生産品目</b>
Lapping abrasives for silicon wafers	シリコンウェハー用ラッピング材
Lapping abrasives for quartz devices	水晶デバイス用ラッピング材
Lapping abrasives for wire-saw slicing	ワイヤーソー切断用砥粒
Precision grinding wheels and pellets for lenses	光学用精密仕上砥石用研磨材
Polishing compounds for silicon wafers	シリコンウェハー用ポリシング材
Polishing compounds for plastic lenses	プラスチックレンズ用ポリシング材
Polishing compounds for hard disks	ハードディスク用ポリシング材
Polishing compounds for CMP	CMP用ポリシング材
Polishing compounds for optical devices	光学用ポリシング材
Thermal spray materials	溶射材
Other abrasives and related products	その他の研磨材および関連製品



Fujimi's headquarters  
(Aichi Prefecture, Japan)  
フジミインコーポレーテッド(本社)



Central Plant  
(Aichi Prefecture, Japan)  
本社工場

**FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.**  
**フジミマイクロテクノロジー (マレーシア)**

**Products manufactured**

Polishing compounds for hard disks

**生産品目**

ハードディスク用ポリシング材



Kakamigahara Plant  
(Gifu Prefecture, Japan)  
各務原工場(岐阜県)



Inazawa Plant  
(Aichi Prefecture, Japan)  
稲沢工場(愛知県)



R&D Center  
(Gifu Prefecture, Japan)  
研究開発センター(岐阜県)

**FUJIMI EUROPE LIMITED**  
**フジミヨーロッパ (イギリス)**

**FUJIMI EUROPE GMBH**  
**フジミヨーロッパ (ドイツ)**



FMT Kulim Plant  
(Kedah, Malaysia)  
FMTクリム工場(マレーシア ケダ州)



No. 2 Kakamihigashimachi Plant  
(Gifu Prefecture, Japan)  
各務東町工場第二棟(岐阜県)



Kakamihigashimachi Plant  
(Gifu Prefecture, Japan)  
各務東町工場(岐阜県)



Logistics Center  
(Gifu Prefecture, Japan)  
物流センター(岐阜県)

## Lapping

### FO Fujimi Optical Emery

In producing semiconductor devices, the surface of the semiconductor wafer, most typically silicon, or a compound semiconductor, must be precisely lapped. The precision lapping abrasive FO, which capitalizes on the best of Fujimi's technology, is the optimal choice for such surface processing. FO is an alumina-based precision lapping powder, made using carefully selected materials, and a product of Fujimi's proprietary manufacturing processes that create a powder with unique particle shape and hardness. Produced under the strictest quality control, FO provides constant, stable lapping capability, with no scratching on the surface of the material being lapped.

半導体素子を製造するには、シリコンに代表される半導体結晶ウェハーや化合物半導体結晶ウェハーを均一に表面加工しなくてはなりません。この表面加工に最適な研磨材が、当社の技術を結集した精密ラッピング材・FOです。FOは厳選された材料を使用し、独自の製造工程によって粒形や硬度に特長を持たせたアルミナがベースとなっています。厳重な品質管理のもとで製造されており、常に安定した研磨能力をもたらすとともに、スクラッチの発生も防止します。



### GC Green Silicon Carbide

Green silicon carbide (GC) is an extremely high-purity silicon carbide lapping abrasive, just beneath diamond in terms of hardness and with excellent chemical stability at room temperature. Owing to these qualities, GC has superior lapping and polishing capabilities, is not affected by chemicals and can spontaneously generate sharp grinding edges through fragmentation. GC is well suited for use as a lapping powder in a wide range of applications, including the precision lapping and dicing of crystal and ferrite and the slicing of silicon ingots. In addition, GC possesses the electrical properties of a semiconductor, conducts heat well and is able to withstand high temperatures, making it useful as heat sink—a cooling device used to dissipate heat away from electronic components.

高いSiC純度を有する緑色炭化けい素研磨材で、その性質はダイヤモンドに次ぐ硬度を保ち、化学的にも常温で非常に安定性があります。したがって薬品等に侵されず、破碎により鋭い切削刃を自生し、優れた研磨力を発揮します。GCは水晶・フェライトの精密ラッピングやダイシング用、シリコンインゴットの切断用など幅広い研磨材料として使用されます。また、電気的に半導体の性質を持ち、熱伝導性が良く高温に耐えることから、ヒートシンク(放熱用部品)の材料にも使用されています。



## Polishing

### GLANZOX Silicon Polish

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, it has become essential to produce silicon surfaces that are extremely flat, nanotopographically mirror-like and free from damage, haze and heavy metal contamination. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirements. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a special solution and ensures an almost perfectly polished surface. In response to demand for reductions in the metal impurities that affect device characteristics, we provide higher grades of polish containing ultrapure colloidal silica.

半導体デバイスの高集積化およびウェハーサイズの大口径化が進むにつれ、シリコンの研磨面には高い平坦性、ダメージフリー、ヘイズフリー、重金属汚染フリーの完全鏡面が要求されています。その要求に応えるために開発されたのがGLANZOXシリーズです。コロイダルシリカを特殊組成液に分散させ、完璧な研磨面の実現を可能にしました。また、デバイス特性に影響する金属不純物の低減要求に対応するため、超高純度コロイダルシリカを開発し、さらに次元の高いポリシング材を提供しています。



### PLANERLITE CMP

PLANERLITE polishing compounds are intended for use in CMP, a key planarization process in the fabrication of high-density ultralarge-scale integration (ULSI) devices. Each series has been developed to enable high levels of purity, high removal rate, high dispersion and scratch-free results. The PLANERLITE-4000 series is designed for use on silicon dioxide (SiO<sub>2</sub>) films employed in interlayer dielectric (ILD) and shallow trench isolation (STI) processes, and is based on ultrapure colloidal silica or fumed silica. The PLANERLITE-6000 series is for use with polysilicon and includes a rinsing agent, which keeps the post-polishing wafer surface hydrophilic, and a variety of polishing compounds that combine special additives with an ultrapure colloidal silica base. The PLANERLITE-7000 series is designed specifically for copper (Cu) circuitry in the damascene process. Based on ultrapure colloidal silica with special additives, it delivers an optimal copper removal rate with excellent selectivity to barrier metals.



PLANERLITEは、高密度化するULSIデバイスの平坦工程に取り入れられたCMP技術に使用されるポリシング材で、高純度、高加工能率、高分散、スクラッチフリーを基本コンセプトに開発された製品です。PLANERLITE-4000シリーズはSiO<sub>2</sub>膜(層間絶縁膜、STI)を対象とし、超高純度コロイダルシリカおよびフュームドシリカをベースマテリアルとするタイプで構成されています。PLANERLITE-6000シリーズはポリシリコンを対象とし、特殊添加剤を配合した超高純度コロイダルシリカベースの各種研磨用タイプと研磨後のウェハー面を親水化処理するリンス剤で構成されています。PLANERLITE-7000シリーズはダマシ工程に使用される銅配線を対象とし、特殊添加剤を配合した超高純度コロイダルシリカをベースとしており、銅に対し高い加工能率とバリアメタルに対する高い選択性を有しています。

## Other Products

### THERMAL SPRAY MATERIALS

In response to a growing need in the thermal spray industry, Fujimi developed SURPREX cermet (ceramic-metallic composite) powders, utilizing highly sophisticated powder technology. Fujimi also offers a variety of ceramic powders and metals, as well as powders for plasma transfer arc (PTA) processes. Recently, ceramic thermal spray materials for various parts of semiconductor manufacturing equipment have generated considerable interest. In light of this, we are working to rapidly develop and produce extremely pure ceramic powders that meet customer requirements.



溶射業界の高いニーズにフジミの高度な粉末加工技術がタイムリーに応え、溶射材料「SURPREX」が誕生しました。金属とセラミックスの複合材であるサーメットを柱に、各種セラミックスや金属、PTA(プラズマ粉末肉盛溶接)用粉末を多数用意しています。近年、半導体製造装置の各種部品へのセラミック溶射が注目されており、当社はタイムリーにニーズに合った高純度セラミック粉末の開発・製造を行っています。

**Semiconductors**

The global semiconductor market grew 28.0%, to us \$213.0 billion (¥23.0 trillion) in 2004, according to the World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). This increase was the highest since 2000 and reflected strong sales of digital electronics products, as well as rising demand for PCs and mobile phones. In 2005, the global semiconductor market is expected to expand 6.3%, to \$226.5 billion.

In autumn 2004, there was a temporary lull in demand as electronic equipment manufacturers adjusted output in response to rising inventories. Nevertheless, demand for the whole year remained firm, owing to the global economic recovery, greater IT investment, the ATHENS 2004 Olympic Games, the U.S. presidential elections and the growth of the Chinese market. Rapid technological change and intense competition to reduce fabrication costs are necessitating substantial capital expenditures by semiconductor manufacturers.

**半導体市場**

2004年半導体市場規模は、WSTS(世界半導体市場統計)春季予測によれば世界全体で2,130億ドル(23.0兆円)、前年比28.0%の大幅な伸びとなり、2000年以来の高成長となりました。これはデジタル関連製品の好調な販売に加え、パソコンや携帯電話の需要増が主な要因です。そして2005年には引き続き2,265億ドルと前年比6.3%の成長を遂げると予想されます。

2004年は、秋以降に一時デバイス機器の在庫増による生産調整から力強さを欠く場面もあったものの、世界経済の回復、企業のIT投資、アテネオリンピック、米国大統領選挙、中国市場の拡大等により、全体的には堅調な動きとなりました。半導体産業は技術革新が著しく、コスト競争も激しく、そして設備投資にかかる負担が膨大なため、ウェハーマーカーも巻き込んだ形で開発競争は今後も続くと思われる。さらには300mmウェハ工場の本格的な稼働や固定研削砥石の一部導入、そして線幅

This will in turn affect silicon wafer manufacturers, triggering still further competition to develop new products. We expect to see more plants for 300-millimeter wafers coming on line and the installation of fine grinding machines by some manufacturers. The intensified competition among manufacturers will encourage the shift to mass production of 300-millimeter wafers using 90-nanometer technology and the introduction of advanced 65-nanometer technology. In this situation, we will strive to remain a customer-driven supplier and an effective partner for our customers.

**CMP**

Manufacturing increasingly high-performance, compact PCs, mobile phones and other types of electronic equipment requires system chips with increasingly high levels of integration. As a consequence, these chips continue to shrink, owing to narrower linewidths, and incorporate increasingly sophisticated multilayered wiring.

90nmの量産化と65nmへの移行など最先端技術への対応が重要となります。当社は、今後ともユーザー本位の姿勢を崩さず、市場が求める要求に即応できるベストパートナーであり続けたいと考えています。

**CMP市場**

パソコンや携帯電話をはじめとする電子機器の高集積化・小型化は、半導体のさらなる高集積化を必要とし、デザインルールの微細化に伴うチップシユリンクと多層配線化の流れを生み出しています。このデザインルールの微細化や多層配線化の進展は従来の平坦化技術での製造を困難とし、特に130nm以細のデザインルールでは、新しい平坦化技術であるCMPが使われています。現在ロジック系半導体では8~9層、デザインルールとしては130nmが主流で、すでに90nmの半導体の量産も開始されています。2007年頃には65nmの量産も予定されており、今後さらに配線の微細化が進み、

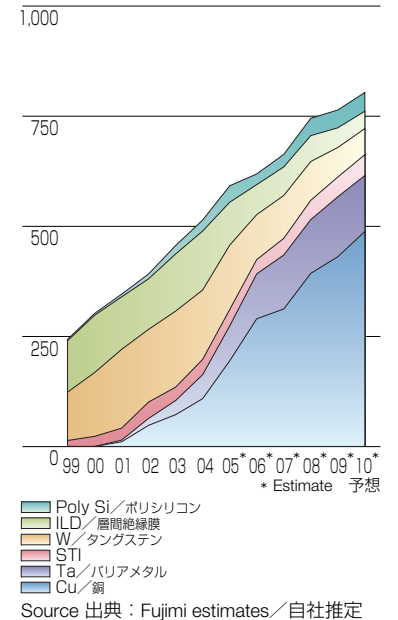
Conventional planarization technology has become ineffective as linewidths decrease and multilayered wiring technology progresses. CMP is the new planarization technology that facilitates the production of chips with linewidths less than 130 nanometers. Although most logic chips currently have eight or nine layers with 130-nanometer linewidths, mass production of semiconductors with 90-nanometer linewidths has already begun. With mass production of semiconductors with 65-nanometer linewidths slated to begin in 2007, we foresee the development of even narrower linewidths and more sophisticated multilayered wiring technology.

An essential part of the multilayered wiring process is ultraprecision planarization, which utilizes mechanochemical processes to facilitate a consistently flat dielectric layer on the wafer surface. Recently, low-resistance copper, which requires CMP, has attracted attention as a next-generation circuitry material for im-

より多層配線化が進展するものと思われます。多層配線プロセスでは、ウェハ表面に均一な厚みの絶縁膜を形成するため、凹凸を化学的機械的に研磨して厚さを均一にする高精度の平坦化技術が必要となります。そのプロセスでは半導体の高機能化の鍵を握る次世代金属配線材料の銅(Cu)がその道を開くものとして注目されています。CMPスラリーの市場規模はここ数年2桁成長を続けており、2007年には約660百万ドルと予測されています。2004年のCMPスラリー市場規模は前年比13%増加の約510百万ドルに達したと推定され、うち層間絶縁膜用、タングステン用がそれぞれ30%、銅配線用は20%を占めたと推定されています。今後ますます微細なデザインルールが進展するとともに、アルミに替わって低抵抗配線材料の銅を使用した半導体デバイスへ移行することから、銅配線用スラリーの割合は増加し、2007年には50%近くに達すると推定されています。その結果、従来CMP用途の主流を占めていたタングステン用や層間

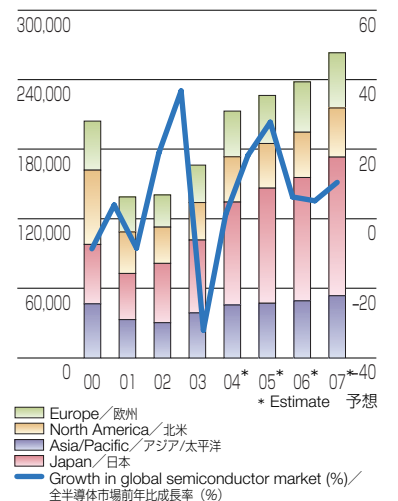
**Global CMP Slurry Market**  
世界における  
CMPスラリー市場規模予測

(Millions of U.S. dollars) (百万米ドル)



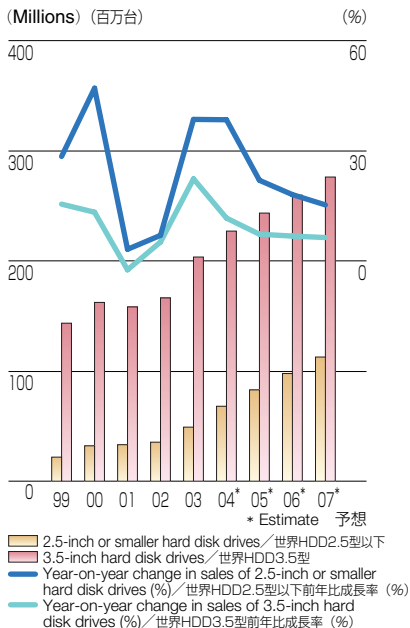
**Key Semiconductor Markets**  
世界の地域別半導体市場規模

(Millions of U.S. dollars) (百万米ドル) (%)



## Global Unit Sales of Hard Disk Drives

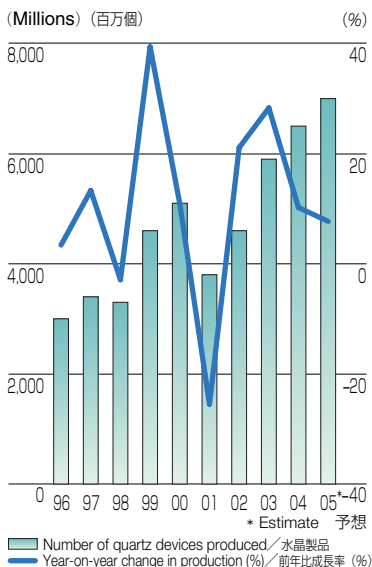
### 世界HDD出荷台数



Source 出典：Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) / 社団法人 電子情報技術産業協会

## Production of Quartz Devices

### 水晶製品生産実績推移



Source 出典：Quartz Crystal Industry Association of Japan / 日本水晶デバイス工業会

proved semiconductor performance.

The global market for CMP polishing compounds is expected to continue its double-digit growth to reach close to US\$660 million in 2007. In 2004, the market increased 13%, to US\$510 million. CMP polishing compounds for interlayer dielectric (ILD) membranes and tungsten (W) plugs accounted for 30% of this total, and compounds for copper wiring represented 20%. As linewidths narrow, we expect low-resistance copper to replace aluminum as a wiring material for semiconductors and to account for as much as 50% of the industry's global CMP polishing compound sales by 2007. This will mean that CMP will be used less for the production of W Plugs and ILD membranes. As a consequence, compounds for W Plugs will account for only 15% of the industry's global CMP polishing compound sales and compounds for ILD membranes only 10% by 2007.

We expect increased demand for CMP

絶縁膜用の比率は減少すると見られ、スラリー全体に占める割合はタングステン用が15%、層間絶縁膜用で10%にまで縮小する見込みです。今後も半導体の高速化・省力化に伴い増加する銅、バリアメタルなどの配線材料を効率よく研磨できる研磨材とパッド、CMP装置が求められます。また、次世代では層間絶縁膜にポーラス状のLow-k材とキャップ層が登場するなど、さらにCMPが複雑化することが予想され、CMPスラリーは高能率、高分散性、高純度性、低スクラッチ、高洗浄性、品質安定性などがさらに求められます。当社では今後とも、シリコンウェハー用ファイナルポリシング材を応用展開し開発した高品質・高性能の超高純度コロイダルシリカスラリーの技術と経験を活かし、対応してまいります。

## ハードディスク市場

民間の市場調査によれば、2004年のHDD世界出荷台数は2億9,580万台と前年比+17%の大幅な増

polishing compounds, pads and systems that enable effective polishing of circuitry materials such as copper and barrier metals, as manufacturers seek to produce faster, energy-efficient semiconductors. However, the emergence of next-generation porous low-k (low dielectric constant) ILD membranes with cap layers will bring further challenges in the field of CMP. Demand is therefore expected to focus on polishing compounds that deliver a high removal rate, outstanding dispersion and purity, a low scratch rate, easy cleaning, and superb quality and stability. Our current goal is to capitalize on the technological expertise and experience that we have gained from the development of high-performance, ultrapure colloidal silica-based final polishing compounds for silicon wafers.

## Hard Disks

Market researchers estimate that 296 million hard disk drives were shipped worldwide in

加となりました。うち3.5型HDDが2億2,760万台(前年比12%増)と全体の77%、2.5型以下HDDは6,820万台(前年比38%増)でした。また、世界のパソコン出荷台数は、景況感の改善で法人によるIT活用の機運の高まり、インターネットのインフラ整備の進展、そして高機能パソコンが低価格で市場投入されたことによる個人の買替需要の増大により、2004年は前年比11.8%増の1億8,300万台に達したものとされます。

ハードディスクはコンピュータ用の外部記憶装置としてパソコン需要の伸びと連動してきましたが、大容量化・高速化・低価格化が進み、デジタル家電や情報端末機器などへの搭載が進み、中でもHDDを搭載したDVDレコーダーはその利便性や操作性の良さから個人の購買意欲を喚起しました。

ディスク基板は、高密度化の進展によりドライブ1台当たり搭載されるディスク枚数が近年減少してきましたが、デジタル家電分野が市場として育つにつれ、ハードディスクは大容量化と搭載枚数の増加

2004, 17% higher than the previous year. Broken down by disk type, 3.5-inch hard disk drives accounted for 228 million of the total, up 12%, and 2.5-inch hard disk drives accounted for 68 million, up 38%. Global PC shipments rose 11.8%, to 183 million, reflecting greater business confidence, which resulted in higher capital investment. The increase was also attributable to stronger replacement demand from consumers, owing to the expansion of the Internet, including the proliferation of high-speed networks, and the launch of high-performance, low-cost PCs.

To date, sales of hard disk drives, the integral storage devices for computers, have grown in tandem with PC sales. With the increasing speed, memory capacity and price competitiveness of hard disks, applications are expanding in such areas as digital consumer electronics and mobile devices. In particular, convenient and easy-to-use DVD/HDD Recorders with built-in hard disk drives have attracted

が見込まれ、1枚当たりの記録容量も80GB(ギガバイト)から120~160GB(ギガバイト)が主流になると予測されます。現在3.5インチアルミディスクが全体の8割近くを占めていますが、ノートパソコンに採用されている2.5インチガラスディスクは、今後さらに進展していくと思われ、携帯情報端末など非PC分野への拡大が確実視されています。ガラスディスクは、アルミに比べて耐熱性・耐久性が高く、高速回転向きで最大記録密度も大きいのがメリットですが、高コストである点が課題となっています。こうした高速・大容量化の流れの中、ディスク面のより高度な平滑性、高品質性が要求されています。

## 水晶デバイス市場

デジタル機器の制御部品である水晶デバイスの市場は、2004年上期の世界的な景気回復や企業のIT投資、アテネオリンピック、中国市場の拡大等を背景として、DVDレコーダー、デジタルカメラなどのデジ

considerable demand from consumers.

Increasingly high recording densities have reduced the number of substrates required in hard disk drives. With growth in the digital home electronics market and demand for higher memory capacity, however, the number of substrates per disk drive will increase again, and substrates with capacities ranging between 120 and 160 gigabytes are expected to dominate the market. Although 3.5-inch aluminum disk substrates currently account for approximately 80% of the global market, demand for 2.5-inch glass disk substrates used in notebook PCs is expected to continue increasing. We also expect greater use of glass disk substrates in products other than PCs, such as personal digital assistants (PDAs). Glass disks are superior to aluminum ones in terms of heat-resistance, durability, rotation speed and areal recording density. Despite the high production costs, we believe the shift toward such high-speed, large-capacity disks will spur demand for smoother and more precise surfaces, thus

タル家電と携帯電話の出荷拡大により好調に推移しました。

特に水晶振動子の需要の8割を占める携帯電話は、第3世代端末の浸透、カラーやカメラ機能付携帯の買替需要の高まり、及び途上国での普及率の向上により、2004年の出荷台数は前年比大幅に増加しました。

今後、品種別では小型・薄型SMD(表面実装型デバイス)の高精度水晶振動子、デジタルスチルカメラ用の光学用ローパスフィルタやBluetooth(Bluetooth:ワイヤレス接続技術)向けの超小型水晶振動子が好調に推移するものと思われます。最近では自動車の電子化に伴いエンジン・ブレーキ制御やドアのオートロックなどに使用されています。また、米国では2004年11月から新車に対し水晶振動子を採用したタイヤ空気圧監視システムの装着が義務づけられています。

市場拡大の一方で、研磨材市場は競争が激化し、中

ensuring a solid market for our polishing compounds.

### Quartz Devices

In 2004, the market for quartz devices—the control components of digital devices—enjoyed strong growth, supported by increased shipments of mobile phones and such digital consumer electronics products as DVD/HDD Recorders and digital cameras. Shipments of mobile phones, which account for 80% of demand for crystal oscillators, rose dramatically in 2004, reflecting market acceptance of third-generation (3G) mobile phones, growing replacement demand from consumers purchasing color-display phones with camera functions, and the spread of mobile phones in developing countries. We anticipate strong demand for compact and thin surface-mount devices (SMDs), such as high-precision crystal oscillators, and ultracompact crystal oscillators for Bluetooth® devices and optical low-pass filters (OLPT) in digital cameras. The increasing use of

国製品を中心に低価格品の参入が相次いでいます。しかしながら高周波化の流れの中、高精度な表面加工処理が求められ、当社では、水晶デバイス市場の中で、特に高付加価値化の進む分野において技術的・品質的優位性を堅持していきたくと考えています。

### 溶射材市場

一般的な溶射材の世界市場規模は、年間約500百万ドルと見られていますが、従来の溶射材は、硬くて耐摩耗性に優れるものの、靱性が低く、衝撃に弱いことから用途が限定されてきました。当社のサーメット溶射材は、こうした弱点を克服し、長年、溶射業界の課題であった耐衝撃性を飛躍的に高め溶射材を高速フレーム溶射機(HVOF=High Velocity Oxygen FuelやHVAF=High Velocity Air Fuel)で溶射することにより、優れた耐食性・耐摩耗性はそのままに、さらに耐衝撃性を飛躍的に向上させた超硬皮膜を形成することを世界で初めて可能とし

electronic components in automobiles is another positive factor; quartz devices are used for engine and brake control, autolocking and other functions. In addition, a law came into effect in the United States in November 2004, requiring all new cars to include tire pressure monitoring systems, which rely on crystal oscillators.

Market expansion has intensified competition among producers of lapping abrasives for quartz devices, a situation that has been exacerbated by a flood of inexpensive products from the People's Republic of China (PRC). With demand for higher frequencies growing, the quartz blanks used in these devices require extremely precise lapping. We aim to maintain our competitive edge in terms of technological superiority and outstanding quality in this important market where extremely high standards prevail.

### Thermal Spray Materials

The annual global market for thermal spray materials is currently estimated at US\$500 million.

した。これにより皮膜表面から飛躍的に凹凸が低減され、溶射後の研磨コストが大幅に低減できるメリットがあり、電子・半導体分野への適用が期待されています。また、環境問題として注目されている六価クロムや廃液処理に課題の残る硬質クロムメッキへの代替技術としてもその可能性が期待されています。

当社では独自のマーケットリサーチを強力に展開していきます。そして新用途開拓への挑戦を続け、さらに半導体製造装置や液晶パネル製造装置等溶射材に使用される高純度アルミナの市場へ進出することにより、事業基盤の強化に努めたいと考えています。

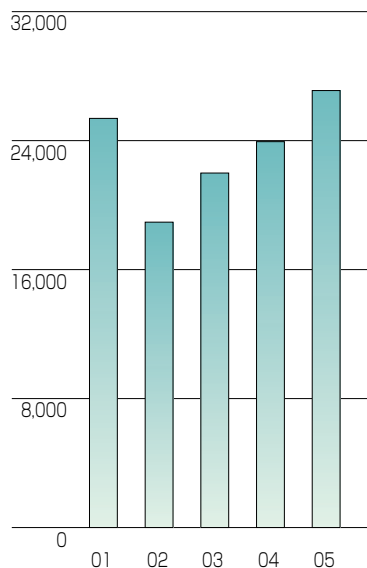
Conventional cermet thermal spray materials offer outstanding hardness and resistance to corrosion, but low impact-resistance and tenacity have limited their widespread use.

Fujimi's cermet thermal spray materials have overcome this long-standing hurdle for the thermal spray industry and ensure vastly improved impact resistance. By utilizing high-velocity oxy-fuel (HVOF) and high-velocity air-fuel (HVAF) spraying processes, our cermet thermal spray materials facilitate for the first time ever ultrahard coatings with no loss of the superb anti-corrosive and anti-abrasive qualities. Another attractive feature of our thermal spray technology is that it drastically reduces surface imperfections, greatly reducing post-spray polishing costs. In view of these advantages, we believe that this technology will find a number of important applications in the electronics and semiconductor fields. It has also been heralded as an environment-friendly alternative to hard chrome plating, a source of toxic hexavalent chromium emissions.

Fujimi will continue to conduct thorough, independent research and cultivate new applications for our products. At the same time, we will strengthen our business base by venturing into the market for ultrapure alumina used in thermal spraying for parts of semiconductor and liquid crystal display (LCD) manufacturing equipment.

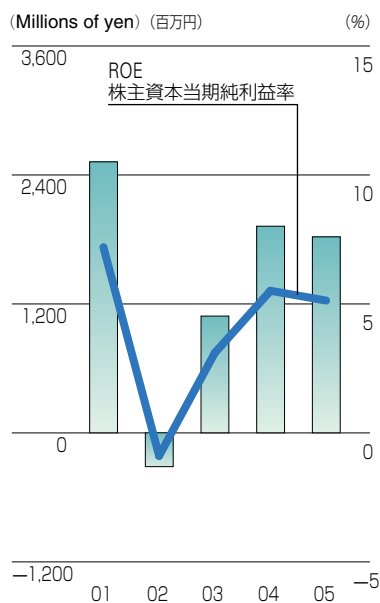
## Net Sales 売上高

(Millions of yen) (百万円)



## Net Income and ROE

当期純利益/株主資本当期純利益率



## FINANCIAL REVIEW (Consolidated) 財務レビュー(連結)

### INCOME AND EXPENSES

#### Sales in Major Product Categories

**Abrasives for silicon wafers:** In fiscal 2005, ended March 31, 2005, the market for semiconductors expanded, owing to a recovery in PC demand, greater shipments of high-end mobile phones and the proliferation of digital consumer electronics. Although sales of the FO series of lapping powders weakened as a consequence of the trend toward recycling by some customers and the use of fine grinding machines, the GLANZOX series of polishing compounds improved dramatically, owing to the increasing use of 300-millimeter silicon wafers. As a result, category sales totaled ¥10.4 billion, up 15.8%.

**Polishing compounds for CMP:** Electronic products, including IT equipment and telecommunications devices, are rapidly becoming more compact and sophisticated with high-performance features. This has spurred demand for semiconductor devices with higher levels of integration and multilayered wiring. An increasing number of users are choosing our superior products, particularly those in our PLANERLITE series. As a reflection of this, category sales rose 19.8%, to ¥6.1 billion.

**Polishing compounds for hard disks:** The expansion of high-speed Internet networks and the launch of high-performance, low-price PCs encouraged consumers to replace older machines, which in turn boosted the market for PC hard disks. Demand remained strong for hard disks in DVD/HDD Recorders, portable digital audio players and other consumer digital electronics products. Owing to these factors, category sales amounted to ¥2.1 billion, up 3.1%.

**Lapping abrasives for wire-saw slicing and quartz devices, thermal spray materials and others:** Sales of lapping abrasives for wire-saw slicing climbed 26.4%, to ¥1.6 billion, owing in particular to demand triggered by growth in the solar cell market. Replacement demand for high-end mobile phones and the increasing use of electronic components in automobiles expanded the market for quartz devices. The shrinking size of liquid crystal devices, however, has reduced the amount of abrasives needed for their production. In addition, an influx of low-priced products from the PRC has put downward pressure on market prices. As a consequence, sales of lapping abrasives for quartz devices fell 12.9%, to ¥730 million. Sales of cermet thermal spray materials rose 53.3%, to ¥480 million.

#### Machine Sales

Machine sales fell 5.7%, to ¥1.3 billion, owing to a decline in replacement demand for lapping machines.

#### Operating Income

The cost of sales ratio improved 0.4 percentage point and operating income rose 16.9%, to ¥3.5 billion. This improvement reflected an increase in sales of highly profitable products that countered a hike in raw material prices affecting some parts of our business. Operating margin was 13.0%.

#### Net Income

Net income was ¥1.8 billion, owing in part to the early adoption of asset impairment accounting standards in the first half of fiscal 2005, which required us to

record an impairment loss of ¥412 million under extraordinary losses. ROE was 5.1%.

#### Cash Dividends

In line with our efforts to return more profits to shareholders, we raised fiscal year-end dividends ¥4.00, to ¥20.00 per share. Combined with interim dividends of ¥16.00, this brought cash dividends for the period to ¥36.00 per share.

### FINANCIAL POSITION

#### Current Assets

Cash on hand and in banks increased, reflecting stronger revenues and the addition of two consolidated European sales subsidiaries to the Fujimi Group. The two companies also accounted for a rise in inventories. As a result, current assets at fiscal year-end were ¥3.6 billion higher than a year earlier.

#### Fixed Assets

Land decreased by ¥420 million, owing to the application of asset impairment accounting standards. Capital expenditure totaled ¥1.8 billion and depreciation and amortization was ¥1.9 billion.

#### Liabilities

Total current liabilities grew ¥1.7 billion, reflecting increases in corporate tax payable and others and the short-term borrowings of Fujimi Corporation. Total long-term liabilities fell ¥244 million, owing primarily to a reduction in the reserve for employee's retirement benefits accompanying changes to our pension system.

#### Shareholders' Equity

Total shareholders' equity grew ¥981 million, as higher retained earnings helped to offset an increase in treasury stock. The equity ratio was 83.0%, down 2.6 percentage points.

#### Cash Flows

Net cash and cash equivalents provided by operating activities totaled ¥3.6 billion, up 43.9%. Significant items included net income before tax and others of ¥3.1 billion, up 1.8%, depreciation and amortization of ¥1.9 billion, down 4.7%, corporate taxes and others of ¥607 million, down 67.1%, and an increase in inventories of ¥1.1 billion.

Net cash and cash equivalents used in investing activities amounted to ¥1.9 billion, a decrease of 38.5%. A key item in this total was purchase of tangible fixed assets of ¥1.7 billion, down 7.2%.

Net cash and cash equivalents used in financing activities fell 63.3%, to ¥519 million, owing mostly to payments for purchase of treasury stock of ¥221 million and cash dividends paid by parent company of ¥471 million.

As a result of the above, cash and cash equivalents at end of year increased ¥1.5 billion, to ¥13.0 billion. In particular, this total was attributable to net income before tax and others of ¥3.1 billion, up 1.8%, and a decrease in corporate taxes and others, which countered increase in receivables and increase in inventories.

## 業績レビュー

### 製品売上高

**半導体ウェハー用**：半導体市場全体は、パソコンの需要回復、携帯電話端末の高機能化による出荷増、デジタル家電製品の需要増大により拡大しました。特に、当社の半導体ウェハー用製品のうち、ラッピング材「FO」は一部リサイクルや砥石による研削の動きから影響を受けたものの、ポリシング材「GLANZOX」は300mmウェハーの拡大により大幅に売上げを伸ばし、半導体ウェハー用製品全体では、売上高103.7億円(前期比15.8%増)となりました。

**CMP用**：IT時代の進展に伴い、情報通信機器やエレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体デバイスについても更なる高集積化・多層配線化が要求されています。その優れた品質特性から「PLANNERLITE」シリーズを中心にユーザーの採用が拡大し、売上高は61.0億円(前期比19.8%増)と順調な伸びを示しました。

**ハードディスク用**：パソコン向けのディスク市場は、インターネットのインフラが整備され、高性能パソコンが低価格で市場投入されたことにより個人の買替需要が増大しました。また、HDD搭載型DVDレコーダーや小口径HDD内蔵型携帯音楽機器等のデジタル家電の拡大によりハードディスクの需要は堅調に推移し、売上高は20.9億円(前期比3.1%増)となりました。

**ワイヤソー用、水晶デバイス用、溶射材、その他**：シリコン切断に使われるワイヤソー用砥粒は、特に太陽電池の市場拡大を受け、この分野向けの製品が牽引役となり大幅に拡大したことから、全体の売上高は15.6億円(前期比26.4%増)となりました。水晶デバイス用は、高性能携帯電話への買替需要や自動車の電装化の進展により市場は拡大したものの、水晶デバイスの小型化による消耗材の使用量減や中国製品の流入による単価下落に伴い、売上高は7.3億円(前期比12.9%減)となりました。サーメット溶射材の伸びは堅調に推移し、売上高は4.8億円(前期比53.3%増)と大幅に増加しました。

**商品売上高**：当社ユーザーの研磨機更新需要の低下により、商品売上高は13.1億円(前期比5.7%減)となりました。

**営業利益**：原材料費値上げの影響を一部受けたものの、利益率の高い製品の売上高増加により、売上原価率が0.4ポイント改善し、営業利益は35.1億円(前期比16.9%増)となり、売上高営業利益率は13.0%となりました。

**当期純利益**：上期に減損処理を前倒適用し、特別損失として4.1億円を計上したため、当期純利益は18.2億円となりました。この結果、株主資本当期純利益率(ROE)は5.1%となりました。

**利益配当金**：当期の利益配当金については、株主各位への利益還元の充実を図るため、1株当たり期末配当金を16円から4円増配して20円としました。この結果、中間配当金(16円)を含めた当期の年間配当金は、1株につき36円となります。

## 財務ポジション

**流動資産**：収益の拡大及び当期より欧州の販売子会社2社が連結対象会社に加わったことに伴い、現金及び預金は増加しました。また、たな卸資産についても連結対象会社が増加したことにより増加し、流動資産は前期末比36.0億円増加しました。

**固定資産**：有形固定資産は、減損処理により土地が4.1億円減少しました。なお、当期の設備投資額は17.8億円、減価償却費は19.2億円となりました。

**負債**：流動負債は、前期末比17.1億円増加しました。未払法人税及び子会社FUJIMI CORPORATIONの短期借入金増加によるものです。固定負債は、退職年金制度の改定に伴う退職給付引当金の取崩しにより2.4億円の減少となりました。

**株主資本**：自己株式を取得したものの、内部留保の増加により株主資本は9.8億円増加しました。株主資本比率は総資産の増加により2.6ポイント減少し83.0%となりました。

### 連結キャッシュフロー

**営業活動によるキャッシュフロー**：営業活動の結果得られた資金は35.8億円(前期比43.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が31.4億円(同1.8%増)計上されたものの、減価償却費が19.2億円と前期比4.7%減少したためです。また、法人税等の支払額が6億円(同67.1%減)と大幅に減少したことに加え、たな卸資産の増加による資金の減少があったことによるものです。

**投資活動によるキャッシュフロー**：投資活動の結果使用した資金は18.5億円(前期比38.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出17.3億円(同7.2%減)によるものです。

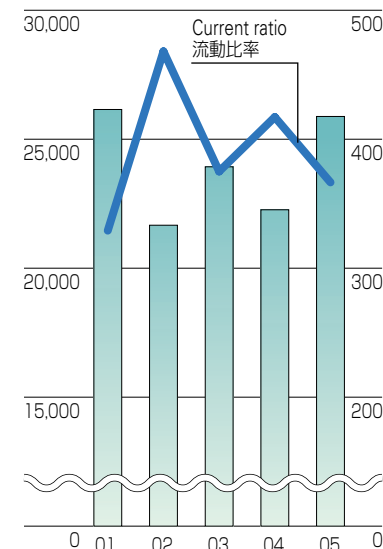
**財務活動によるキャッシュフロー**：財務活動の結果使用した資金は5.1億円(前期比63.3%減)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出2.2億円及び親会社による配当金の支払額4.7億円によるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が31.4億円(前期比1.8%増)となり、売上債権の増加及びたな卸資産の増加があったものの、法人税等支払額の減少により、前連結会計年度末に比べ15.5億円増加しました。この結果、資金残高は129.6億円となりました。

## Current Assets and Current Ratio

### 流動資産/流動比率

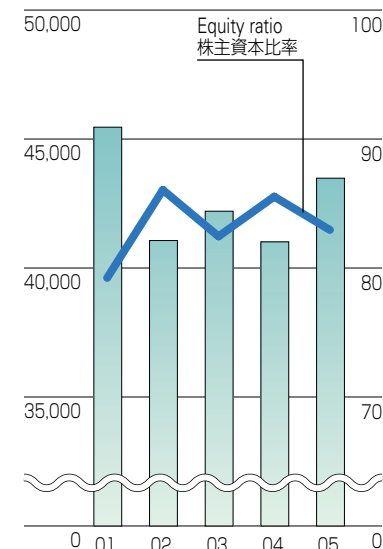
(Millions of yen) (百万円) (%)



## Total Assets and Equity Ratio

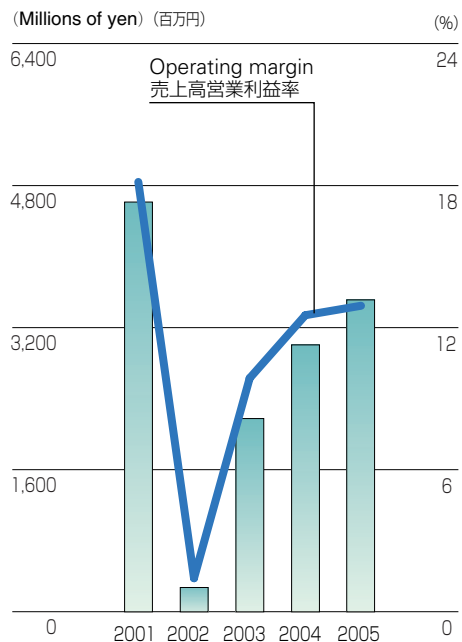
### 総資産/株主資本比率

(Millions of yen) (百万円) (%)

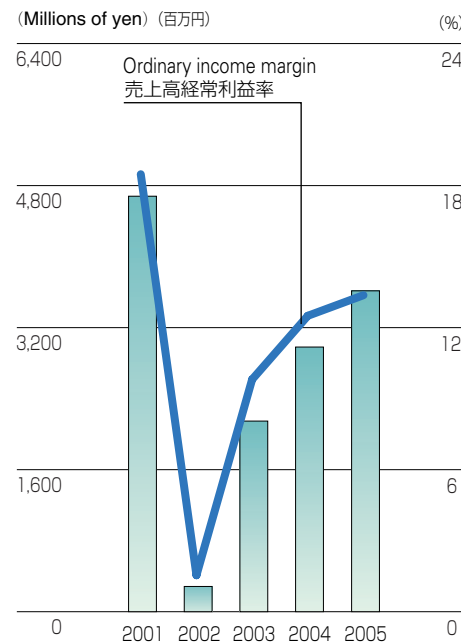


Profitability 収益性

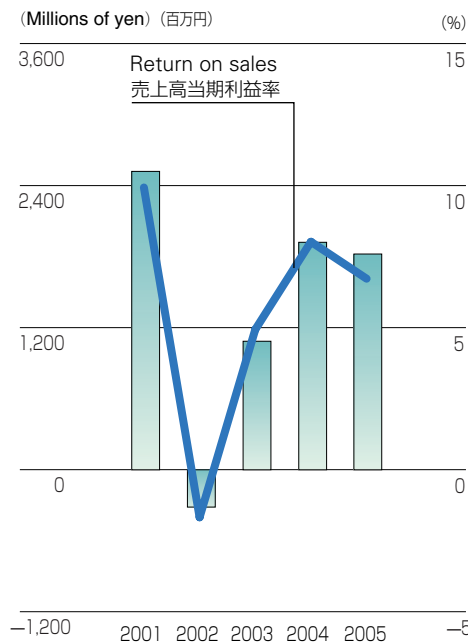
Operating Income and Operating Margin  
営業利益/売上高営業利益率



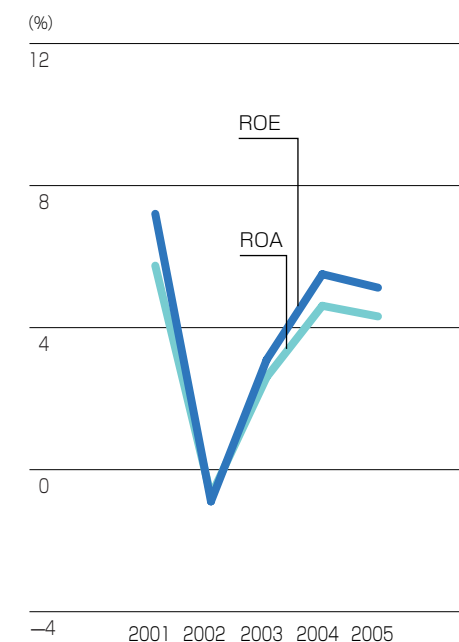
Ordinary Income and Ordinary Income Margin  
経常利益/売上高経常利益率



Net Income and Return on Sales  
当期純利益/売上高当期純利益率



Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)  
株主資本当期純利益率/総資産利益率



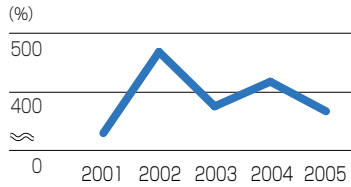
Fiscal years ended March 31

		2001 平成 13 年 3 月期	2002 平成 14 年 3 月期	2003 平成 15 年 3 月期	2004 平成 16 年 3 月期	2005 平成 17 年 3 月期
Net sales (millions of yen)	売上高(百万円)	25,382	18,945	21,992	23,938	27,109
Operating income (millions of yen)	営業利益(百万円)	4,616	274	2,177	3,007	3,514
Operating margin (%)	売上高営業利益率(%)	18.19	1.45	9.90	12.56	12.96
Ordinary income (millions of yen)	経常利益(百万円)	4,680	284	2,147	2,981	3,614
Ordinary income margin (%)	売上高経常利益率(%)	18.44	1.50	9.77	12.46	13.33
Net income (millions of yen)	当期純利益(百万円)	2,521	(315)	1,086	1,922	1,823
Return on sales (%)	売上高当期純利益率(%)	9.94	-1.67	4.94	8.03	6.73
ROE (%)	株主資本利益率(%)	7.21	-0.89	3.10	5.51	5.13
ROA (%)	総資産利益率(%)	5.75	-0.73	2.61	4.62	4.32

## Stability 安定性

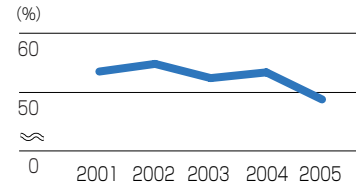
### Current Ratio

流動比率



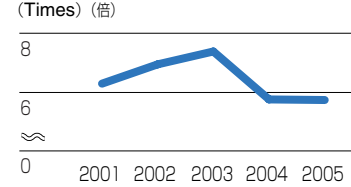
### Fixed Asset Ratio

固定比率



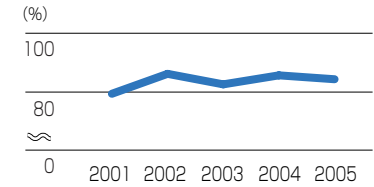
### Current (Quick) Ratio

手元流動性比率



### Equity Ratio

株主資本比率



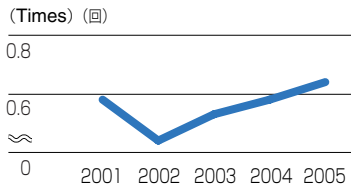
Fiscal years ended March 31

		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Current ratio (%)	流動比率 (%)	329.54	468.50	375.38	417.55	366.94
Fixed asset ratio (%)	固定比率 (%)	53.52	54.83	52.40	53.38	48.75
Current (quick) ratio (times)	手元流動性比率 (倍)	6.30	6.96	7.40	5.76	5.74
Equity ratio (%)	株主資本比率 (%)	79.25	86.07	82.47	85.55	82.97

## Productivity and Efficiency 生産性/効率性

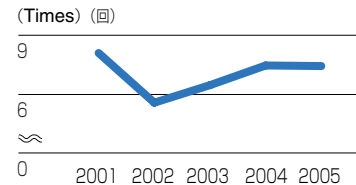
### Asset Turnover

総資産回転率



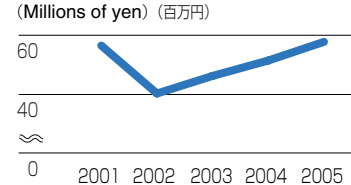
### Inventory Turnover

たな卸資産回転率



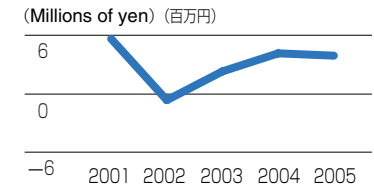
### Net Sales Per Employee

従業員1人当たり売上高



### Net Income Per Employee

従業員1人当たり当期純利益



Fiscal years ended March 31

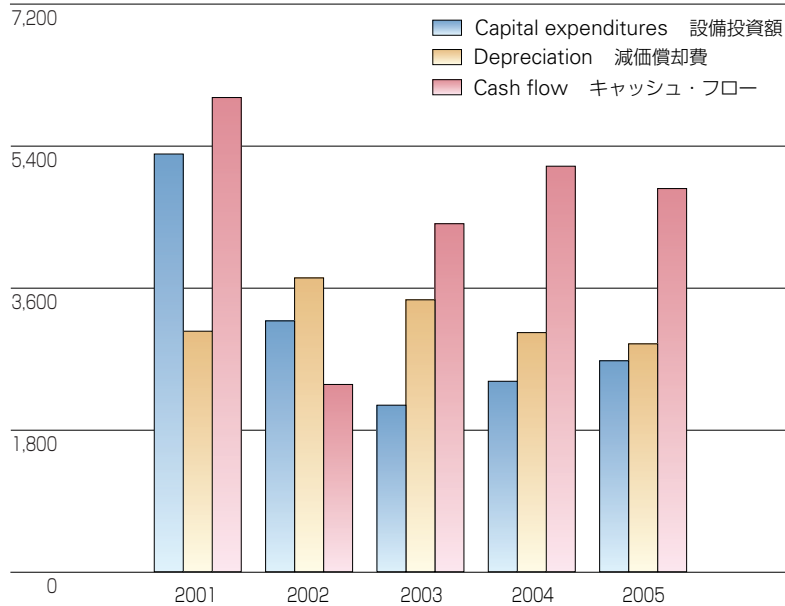
		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Asset turnover (times)	総資産回転率 (回)	0.58	0.44	0.53	0.58	0.64
Inventory turnover (times)	たな卸資産回転率 (回)	8.13	5.58	6.48	7.49	7.46
Net sales per employee (millions of yen)	従業員1人当たり売上高 (百万円)	56.53	40.14	46.15	51.42	57.80
Net income per employee (millions of yen)	従業員1人当たり当期純利益 (百万円)	5.62	(0.67)	2.28	4.13	3.89
Number of employees	従業員数 (人)	458	486	467	464	474

## Capital Expenditures and Research & Development 設備投資／研究開発

### Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー

(Millions of yen) (百万円)

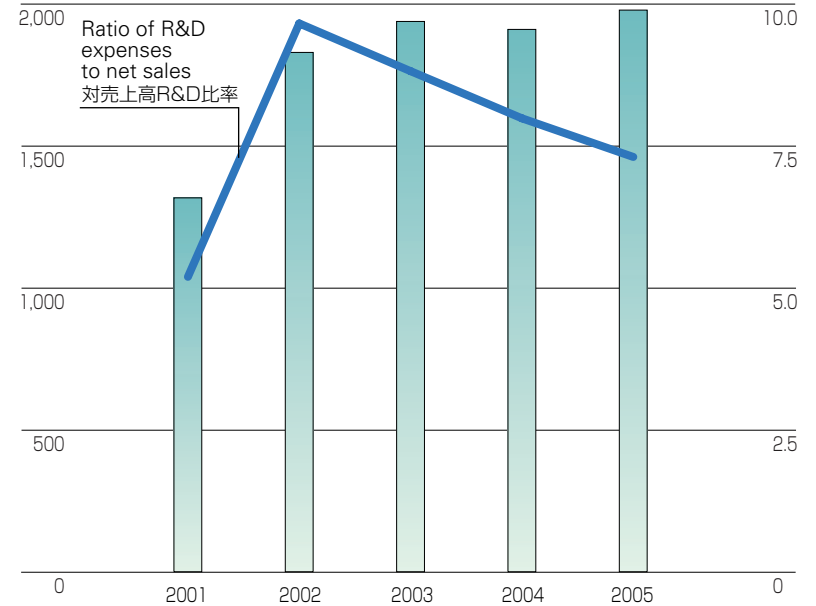


### R&D Expenses and Ratio of R&D Expenses to Net Sales

研究開発費/対売上高R&D比率

(Millions of yen) (百万円)

(%)



Fiscal years ended March 31

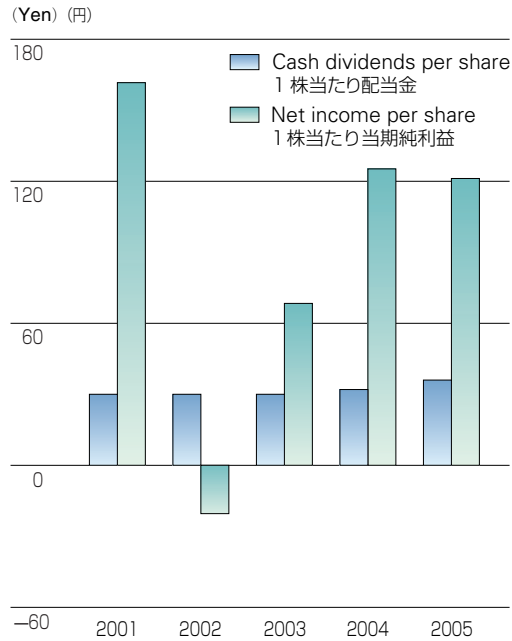
		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Capital expenditures (millions of yen)	設備投資額(百万円)	3,529	2,119	1,407	1,609	1,782
Depreciation (millions of yen)	減価償却費(百万円)	2,032	2,482	2,297	2,020	1,925
Cash flow (millions of yen)	キャッシュ・フロー(百万円)	4,006	1,582	2,940	3,426	3,237
R&D expenses (millions of yen)	研究開発費(百万円)	1,316	1,828	1,937	1,909	1,977
Ratio of R&D expenses to net sales (%)	対売上高R&D比率(%)	5.19	9.65	8.81	7.98	7.30

Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends - Directors' bonuses

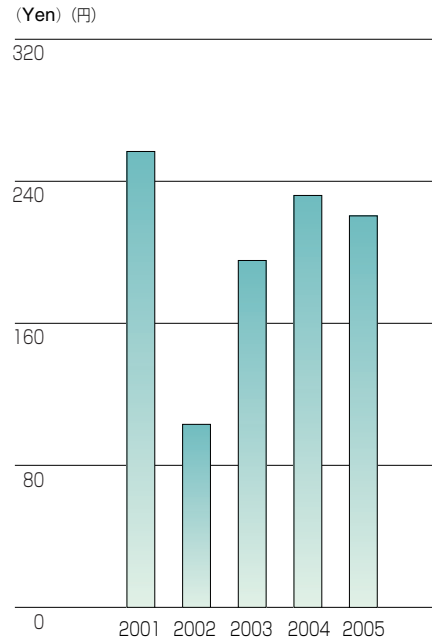
注：キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 支払配当金 - 役員賞与金

## Per Share Data and Others 投資指標

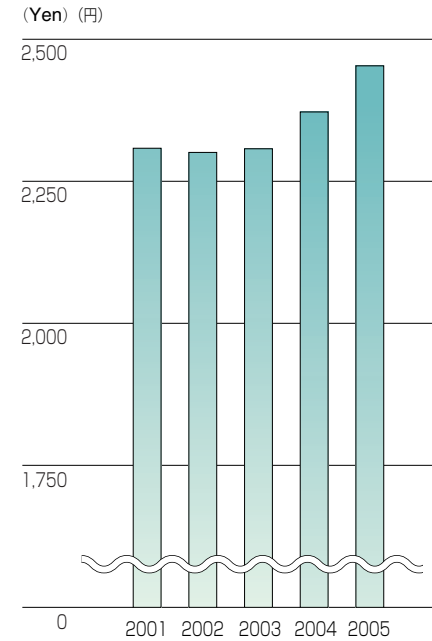
### Cash Dividends per Share and Net Income per Share 1株当たり配当金/1株当たり当期純利益



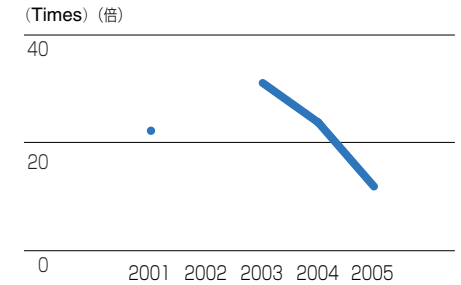
### Cash Flow per Share 1株当たりキャッシュ・フロー



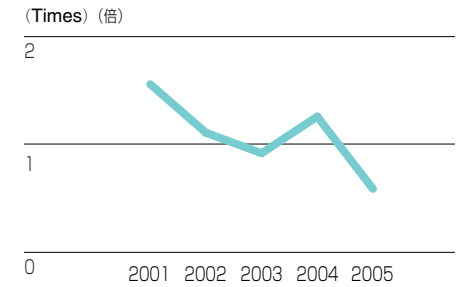
### Shareholders' Equity per Share 1株当たり株主資本



### Price-to-Earnings Ratio (PER) 株価収益率



### Price-to-Book Value Ratio (PBR) 株価株主資本倍率



Fiscal years ended March 31

		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Cash dividends per share (yen)	1株当たり配当金(円)	30.00	30.00	30.00	32.00	36.00
Net income per share (yen)	1株当たり当期純利益(円)	161.64	(20.43)	68.39	125.21	121.16
Cash flow per share (yen)	1株当たりキャッシュ・フロー(円)	256.79	103.09	195.39	232.02	220.53
Shareholders' equity per share (yen)	1株当たり株主資本(円)	2,307.01	2,300.78	2,307.60	2,371.68	2,452.69
PER (times)	株価収益率(倍)	22.27	-	31.14	23.80	23.85*
PBR (times)	株価株主資本倍率(倍)	1.56	1.11	0.92	1.26	1.18*

Note: Although we implemented a 2-for-1 stock split on March 31, 2005, PER and PBR for fiscal 2005 have been calculated using the value of each share before the stock split.

注：平成17年3月31日を基準日として1株につき2株の割合をもって株式分割を実施していますが、平成17年3月期の株価収益率及び株価株主資本倍率は権利落ち前のベースの株価で試算しています。

# CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 連結貸借対照表

(Thousands of yen) (千円)

As of March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
<b>ASSETS</b>	<b>資産の部</b>					
Current assets	流動資産					
Cash on hand and in banks	現金及び預金	5,860,400	7,312,120	13,291,207	10,869,864	12,594,996
Trade notes and accounts receivable	受取手形及び売掛金	8,769,560	5,981,332	6,173,865	7,345,453	7,839,892
Marketable securities	有価証券	7,466,524	1,664,477	274,090	615,918	374,692
Inventories	たな卸資産	3,390,028	3,403,424	3,384,296	3,006,039	4,262,330
Deferred tax assets	繰延税金資産	199,858	94,546	638,908	342,050	626,691
Short-term loans receivable	短期貸付金	902	2,008,081	1,812	1,382	1,360
Other current assets	その他の流動資産	492,652	1,223,387	213,592	108,355	199,683
Reserve for doubtful accounts	貸倒引当金	(27,058)	(17,739)	(33,000)	(16,000)	(25,000)
<b>Total current assets</b>	<b>流動資産合計</b>	<b>26,152,869</b>	<b>21,669,629</b>	<b>23,944,773</b>	<b>22,273,064</b>	<b>25,874,649</b>
Fixed assets	固定資産					
Tangible fixed assets	有形固定資産					
Buildings	建物	6,648,707	6,971,424	6,384,430	6,284,413	6,487,377
Machinery and/or transportation equipment	機械装置及び運搬具	4,286,708	4,161,512	3,253,646	2,879,433	2,755,572
Land	土地	3,953,633	4,001,483	3,985,934	3,949,434	3,528,938
Other tangible fixed assets	その他の有形固定資産	1,845,530	1,777,696	1,990,346	1,826,288	1,496,176
<b>Total tangible fixed assets</b>	<b>有形固定資産合計</b>	<b>16,734,580</b>	<b>16,912,116</b>	<b>15,614,358</b>	<b>14,939,570</b>	<b>14,268,064</b>
Intangible fixed assets	無形固定資産	427,123	571,959	484,399	417,592	366,185
Investments and other	投資その他の資産					
Investment securities	投資有価証券	1,469,011	614,153	698,338	804,014	828,241
Long-term loans receivable	長期貸付金	2,299	4,221	2,408	372,724	3,153
Deferred tax assets	繰延税金資産	391,824	544,861	407,960	264,055	149,679
Other investments and assets	その他の投資その他の資産	278,595	758,240	1,055,261	1,949,191	1,987,469
Reserve for doubtful accounts	貸倒引当金	(38,129)	(42,585)	(39,525)	(29,500)	(29,200)
<b>Total investments and other</b>	<b>投資その他の資産合計</b>	<b>2,103,601</b>	<b>1,878,890</b>	<b>2,124,443</b>	<b>3,360,485</b>	<b>2,939,344</b>
<b>Total fixed assets</b>	<b>固定資産合計</b>	<b>19,265,305</b>	<b>19,362,967</b>	<b>18,223,201</b>	<b>18,717,648</b>	<b>17,573,595</b>
<b>Total assets</b>	<b>資産合計</b>	<b>45,418,174</b>	<b>41,032,596</b>	<b>42,167,974</b>	<b>40,990,712</b>	<b>43,448,244</b>

(Thousands of yen) (千円)

As of March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
<b>LIABILITIES</b>	負債の部					
<b>Current liabilities</b>	流動負債					
Trade notes payable and accounts payable	支払手形及び買掛金	3,741,016	2,281,878	2,629,935	3,110,052	3,641,550
Short-term borrowings	短期借入金	1,083,871	1,359,287	697,450	449,946	604,418
Corporate tax payable and others	未払法人税等	970,087	—	1,155,000	137,393	1,052,121
Reserve for accrued bonus	賞与引当金	423,923	238,298	413,850	417,547	470,585
Other current liabilities	その他の流動負債	1,717,260	745,848	1,482,508	1,219,256	1,282,882
<b>Total current liabilities</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>7,936,160</b>	<b>4,625,312</b>	<b>6,378,745</b>	<b>5,334,196</b>	<b>7,051,557</b>
<b>Long-term liabilities</b>	固定負債					
Long-term borrowings	長期借入金	308,037	—	—	—	—
Deferred tax liabilities	繰延税金負債	67,358	90,732	42,931	6,887	18,458
Reserve for employees' retirement benefits	退職給付引当金	561,829	446,751	410,525	431,328	71,758
Reserve for directors' retirement allowances	役員退職引当金	549,852	522,526	530,076	117,478	—
Long-term accounts payable	長期未払金	—	—	—	—	221,008
<b>Total long-term liabilities</b>	<b>固定負債合計</b>	<b>1,487,077</b>	<b>1,060,010</b>	<b>983,533</b>	<b>555,693</b>	<b>311,225</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>負債合計</b>	<b>9,423,238</b>	<b>5,685,323</b>	<b>7,362,278</b>	<b>5,889,889</b>	<b>7,362,783</b>
<b>MINORITY INTEREST</b>	少数株主持分	—	32,416	29,997	32,708	36,364
<b>SHAREHOLDERS' EQUITY</b>	資本の部					
Common stock	資本金	4,753,438	4,753,438	—	—	—
Legal reserve for capital surplus	資本準備金	5,038,501	5,038,501	—	—	—
Retained earnings	連結剰余金	26,135,750	24,751,277	—	—	—
for consolidated subsidiaries						
Gain or loss on revaluation of other securities	その他有価証券評価差額金	(108,509)	1,387	—	—	—
Foreign currency translation adjustment	為替換算調整勘定	175,778	771,613	—	—	—
Treasury stock	自己株式	(22)	(1,361)	—	—	—
<b>Total shareholders' equity</b>	<b>資本合計</b>	<b>35,994,936</b>	<b>35,314,856</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Common stock	資本金	—	—	4,753,438	4,753,438	4,753,438
Retained earnings for capital surplus	資本剰余金	—	—	5,038,501	5,038,501	5,040,075
Retained earnings	利益剰余金	—	—	25,394,114	26,800,275	28,112,489
Gain or loss on revaluation of other securities	その他有価証券評価差額金	—	—	(21,269)	80,381	93,782
Foreign currency translation adjustment	為替換算調整勘定	—	—	378,761	(75,280)	(199,217)
Treasury stock	自己株式	—	—	(767,847)	(1,529,202)	(1,751,472)
<b>Total shareholders' equity</b>	<b>資本合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>34,775,698</b>	<b>35,068,114</b>	<b>36,049,096</b>
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b>負債及び少数株主持分及び資本合計</b>	<b>45,418,174</b>	<b>41,032,596</b>	<b>42,167,974</b>	<b>40,990,712</b>	<b>43,448,244</b>

# CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME 連結損益計算書

(Thousands of yen) (千円)

Fiscal years ended March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Ordinary income and expenses	経常損益の部					
Operating income and expenses	営業損益の部					
Net sales	売上高	25,382,833	18,945,292	21,992,159	23,938,874	27,109,070
Cost of sales	売上原価	16,455,900	14,281,035	14,997,971	16,191,570	18,206,495
Gross profit	売上総利益	8,926,932	4,664,256	6,994,187	7,747,304	8,902,575
Selling, general and administrative (SG&A) expenses	販売費及び一般管理費	4,310,434	4,389,354	4,816,414	4,739,852	5,388,328
Operating income	営業利益	4,616,498	274,902	2,177,773	3,007,451	3,514,246
Nonoperating income and expenses	営業外損益の部					
Interest income	受取利息	70,838	39,429	49,971	32,743	31,874
Dividend income	受取配当金	11,111	1,641	1,579	1,543	2,407
Other nonoperating income	その他の営業外収益	83,675	67,666	36,596	56,467	99,355
Nonoperating income	営業外収益	165,625	108,737	88,149	90,754	133,637
Interest expenses	支払利息	76,478	56,427	47,006	17,841	30,436
Other nonoperating expenses	その他の営業外費用	25,580	42,715	71,319	98,453	3,204
Nonoperating expenses	営業外費用	102,058	99,143	118,326	116,295	33,640
Ordinary income	経常利益	4,680,065	284,496	2,147,595	2,981,910	3,614,243
Extraordinary items	特別損益の部					
Proceeds from sales of fixed assets	固定資産売却益	-	-	-	30,469	-
Damage compensation	損害補償金収入	-	-	-	-	32,031
Received subsidy	受取補助金	311,400	-	-	-	-
Allowance for doubtful receivables	貸倒引当金戻入益	38,400	9,663	-	-	-
Proceeds from sales of investment securities	投資有価証券売却益	-	-	-	133,248	-
Other extraordinary income	その他の特別利益	47,400	-	8,285	5,682	12,196
Extraordinary income	特別利益	397,200	9,663	8,285	169,399	44,227
Loss on disposal of fixed assets	固定資産除売却損	196,653	33,189	56,115	46,307	27,681
Loss on revaluation of investment securities	投資有価証券評価損	-	567,687	95,171	-	-
Loss from flood damage	水害損失金	297,479	-	-	-	-
Impairment loss	減損損失	-	-	-	-	412,373
Other extraordinary losses	その他の特別損失	158,841	40,861	119,552	12,086	70,584
Extraordinary losses	特別損失	652,973	641,739	270,838	58,393	510,638
Net income (loss) before tax and others	税金等調整前当期純利益(損失)	4,424,291	(347,578)	1,885,042	3,092,917	3,147,832
Corporate, local income and enterprise taxes	法人税、住民税及び事業税	1,963,317	70,926	1,239,137	780,428	1,490,333
Income tax and other adjustments	法人税等調整額	(60,941)	(108,255)	(444,232)	383,359	(170,478)
Minority interest in earnings of consolidated subsidiaries	少数株主利益	-	5,428	4,132	6,482	4,715
Net income	当期純利益	2,521,915	(315,678)	1,086,004	1,922,647	1,823,262

# CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 連結キャッシュ・フロー計算書

(Thousands of yen) (千円)

Fiscal years ended March 31		2002 平成 14 年 3 月期	2003 平成 15 年 3 月期	2004 平成 16 年 3 月期	2005 平成 17 年 3 月期
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		営業活動によるキャッシュ・フロー			
Net income (loss) before tax and others	税金等調整前当期純利益(損失)	(347,578)	1,885,042	3,092,917	3,147,832
Depreciation and amortization	減価償却費	2,482,071	2,297,490	2,020,681	1,925,555
Loss on revaluation of investment securities	投資有価証券評価損	567,687	95,171	—	—
(Increase) decrease in receivables	売上債権増減額	2,977,535	(279,716)	(1,268,261)	(850,782)
Increase (decrease) in payables	仕入債務増減額	(1,714,127)	414,799	571,555	697,975
(Increase) decrease in inventories	たな卸資産増減額	330,939	(105,328)	252,579	(1,101,526)
Others	その他	(36,020)	1,692,073	(301,517)	376,709
Provision for bonuses to directors	役員賞与の支払額	(80,000)	—	(50,000)	(40,000)
Subtotal	小計	4,180,507	5,999,533	4,317,954	4,155,763
Interest and dividends received	利息及び配当金の受取額	41,071	30,162	34,287	34,281
Subsidies received	受取補助金の収入	311,400	—	—	—
Damage compensation	損害補償金の収入	—	—	—	32,031
Interest paid	利息の支払額	(56,427)	(47,006)	(17,841)	(30,436)
Corporate taxes and others	法人税等の支払額	(2,143,882)	(111,136)	(1,843,872)	(607,063)
Net cash and cash equivalents provided by operating activities	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,332,667	5,871,553	2,490,527	3,584,577
<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		投資活動によるキャッシュ・フロー			
Payments for purchase of marketable securities	有価証券の取得による支出	(549,456)	(99,950)	—	—
Proceeds from sales of marketable securities	有価証券の売却による収入	254,447	581,263	—	66,531
Purchase of tangible fixed assets	有形固定資産取得による支出	(2,749,679)	(706,028)	(1,872,416)	(1,738,071)
Purchase of shares in subsidiaries and affiliates	子会社株式取得による支出	—	—	(937)	—
Others	その他	(860,923)	(693,360)	(1,135,147)	(179,808)
Net cash and cash equivalents used in investing activities	投資活動によるキャッシュ・フロー	(3,905,612)	(918,075)	(3,008,501)	(1,851,348)
<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		財務活動によるキャッシュ・フロー			
Increase (decrease) in short-term borrowings	短期借入金の純増減額	256,758	(572,600)	(185,728)	172,800
Repayment of long-term borrowings	長期借入金の返済による支出	(437,968)	—	—	—
Proceeds from sales of (payments for purchase of) treasury stock	自己株式の取得及び売却による収支	(542,247)	(766,486)	(761,354)	(220,696)
Cash dividends paid by parent company	親会社による配当金の支払額	(504,020)	(443,167)	(466,486)	(471,048)
Net cash and cash equivalents used in financing activities	財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,227,477)	(1,782,253)	(1,413,568)	(518,944)
<b>ADJUSTMENT FOR CONVERSION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		現金及び現金同等物に係る換算差額			
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	現金及び現金同等物の増減額	(2,760,413)	3,089,071	(2,071,432)	1,193,450
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS RESULTING FROM CHANGE IN SCOPE OF CONSOLIDATION	新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額	90,085	—	—	356,451
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR	現金及び現金同等物期首残高	13,072,477	10,402,149	13,491,220	11,419,787
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR	現金及び現金同等物期末残高	10,402,149	13,491,220	11,419,787	12,969,689

# NONCONSOLIDATED BALANCE SHEETS 単独貸借対照表

(Thousands of yen) (千円)

As of March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
<b>ASSETS</b>	<b>資産の部</b>					
Current assets	流動資産					
Cash on hand and in banks	現金及び預金	5,380,174	6,579,320	12,297,838	10,001,597	11,678,407
Trade notes receivable	受取手形	2,961,994	1,976,773	1,878,721	2,167,665	2,266,692
Accounts receivable	売掛金	5,243,740	3,622,114	4,165,424	5,070,960	5,528,322
Marketable securities	有価証券	7,466,524	1,344,879	200,012	200,020	200,027
Inventories	たな卸資産	2,229,351	2,151,617	2,240,891	2,193,181	2,940,764
Deferred tax assets	繰延税金資産	168,219	—	534,839	227,521	390,448
Short-term loans receivable	短期貸付金	55,619	2,057,591	57,056	109,470	148,494
Other current assets	その他の流動資産	522,776	881,545	32,947	60,991	110,562
Reserve for doubtful accounts	貸倒引当金	(29,795)	(17,739)	(33,000)	(16,000)	(25,000)
<b>Total current assets</b>	<b>流動資産合計</b>	<b>23,998,605</b>	<b>18,596,103</b>	<b>21,374,731</b>	<b>20,015,408</b>	<b>23,238,722</b>
Fixed assets	固定資産					
Tangible fixed assets	有形固定資産					
Buildings	建物	5,110,423	5,139,482	4,784,846	4,642,264	4,418,462
Machinery and equipment	機械及び装置	3,368,650	3,065,752	2,581,615	2,491,168	2,332,647
Land	土地	3,634,400	3,634,400	3,651,400	3,651,400	3,239,027
Other tangible fixed assets	その他の有形固定資産	2,081,949	2,123,546	2,070,309	1,454,503	1,577,125
<b>Total tangible fixed assets</b>	<b>有形固定資産合計</b>	<b>14,195,423</b>	<b>13,963,182</b>	<b>13,088,172</b>	<b>12,239,336</b>	<b>11,567,261</b>
Intangible fixed assets	無形固定資産	99,603	408,199	484,399	417,592	366,185
Investments and other	投資その他の資産					
Investment securities	投資有価証券	960,460	614,153	698,338	803,077	828,241
Investments in subsidiaries and affiliates	関係会社株式	2,575,065	2,948,145	2,948,145	2,949,083	2,949,083
Deferred tax assets	繰延税金資産	391,824	544,861	407,960	256,449	149,679
Other	その他	408,494	830,362	1,071,618	2,766,040	2,469,533
<b>Total investments and other</b>	<b>投資その他の資産合計</b>	<b>4,335,844</b>	<b>4,937,522</b>	<b>5,126,063</b>	<b>6,774,649</b>	<b>6,396,538</b>
<b>Total fixed assets</b>	<b>固定資産合計</b>	<b>18,630,871</b>	<b>19,308,905</b>	<b>18,698,634</b>	<b>19,431,578</b>	<b>18,329,985</b>
<b>Total assets</b>	<b>資産合計</b>	<b>42,629,477</b>	<b>37,905,008</b>	<b>40,073,365</b>	<b>39,446,986</b>	<b>41,568,707</b>

(Thousands of yen) (千円)

As of March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
<b>LIABILITIES</b>	負債の部					
<b>Current liabilities</b>	流動負債					
Trade notes payable	支払手形	1,124,634	626,802	560,897	737,109	875,471
Accounts payable	買掛金	2,299,718	1,625,867	2,004,680	2,393,574	2,518,484
Short-term borrowings	短期借入金	292,000	170,000	—	—	—
Corporate tax payable and others	未払法人税等	935,000	—	1,155,000	96,000	1,024,170
Reserve for accrued bonus	賞与引当金	423,923	238,298	413,850	417,547	470,585
Other current liabilities	その他の流動負債	1,606,785	504,229	1,267,007	911,491	990,667
<b>Total current liabilities</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>6,682,060</b>	<b>3,165,197</b>	<b>5,401,436</b>	<b>4,555,722</b>	<b>5,879,379</b>
<b>Long-term liabilities</b>	固定負債					
Long-term borrowings	長期借入金	170,000	—	—	—	—
Provision for allowance for employees' retirement benefits	退職給付引当金	561,829	446,751	410,525	431,328	71,758
Reserve for directors' retirement allowances	役員退職引当金	549,852	522,526	530,076	117,478	—
Long-term accounts payable	長期未払金	—	—	—	—	221,008
<b>Total long-term liabilities</b>	<b>固定負債合計</b>	<b>1,281,681</b>	<b>969,278</b>	<b>940,602</b>	<b>548,806</b>	<b>292,767</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>負債合計</b>	<b>7,963,742</b>	<b>4,134,475</b>	<b>6,342,038</b>	<b>5,104,529</b>	<b>6,172,147</b>
<b>SHAREHOLDERS' EQUITY</b>	資本の部					
Common stock	資本金	4,753,438	4,753,438	—	—	—
Legal reserve for capital surplus	資本準備金	5,038,501	5,038,501	—	—	—
Legal reserve for retained earnings	利益準備金	322,596	362,596	—	—	—
Retained earnings	剰余金	24,659,707	23,615,971	—	—	—
Voluntary reserve	任意積立金	21,890,000	22,990,000	—	—	—
Unappropriated retained earnings	当期末処分利益金	2,769,707	625,971	—	—	—
Gain or loss on revaluation of other securities	その他有価証券評価差額金	(108,509)	1,387	—	—	—
Treasury stock	自己株式	—	(1,361)	—	—	—
<b>Total shareholders' equity</b>	<b>資本合計</b>	<b>34,665,734</b>	<b>33,770,533</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Common stock	資本金	—	—	4,753,438	4,753,438	4,753,438
Retained earnings for capital surplus	資本剰余金	—	—	5,038,501	5,038,501	5,040,075
Retained earnings	利益剰余金	—	—	24,728,504	25,999,337	27,260,735
Legal reserve for retained earnings	利益準備金	—	—	362,596	362,596	362,596
Voluntary reserve	任意積立金	—	—	22,990,000	22,990,000	22,990,000
Unappropriated retained earnings	当期末処分利益金	—	—	1,375,907	2,646,741	3,908,139
Gain or loss on revaluation of other securities	その他有価証券評価差額金	—	—	(21,269)	80,381	93,782
Treasury stock	自己株式	—	—	(767,847)	(1,529,202)	(1,751,472)
<b>Total shareholders' equity</b>	<b>資本合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33,731,326</b>	<b>34,342,457</b>	<b>35,396,560</b>
<b>Total liabilities and shareholders' equity</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>42,629,477</b>	<b>37,905,008</b>	<b>40,073,365</b>	<b>39,446,986</b>	<b>41,568,707</b>

# NONCONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND RETAINED EARNINGS 単独損益計算書

(Thousands of yen) (千円)

Fiscal years ended March 31		2001 平成13年3月期	2002 平成14年3月期	2003 平成15年3月期	2004 平成16年3月期	2005 平成17年3月期
Ordinary income and expenses	経常損益の部					
Operating income and expenses	営業損益の部					
Net sales	売上高	22,726,505	15,207,127	18,684,215	20,754,080	23,422,079
Cost of sales	売上原価	14,906,571	10,982,635	12,762,201	14,162,775	15,835,683
Gross profit	売上総利益	7,819,933	4,224,491	5,922,014	6,591,305	7,586,395
Selling, general and administrative (SG&A) expenses	販売費及び一般管理費	3,589,932	3,514,841	3,774,780	3,832,668	4,328,096
Operating income	営業利益	4,230,001	709,650	2,147,233	2,758,636	3,258,298
Nonoperating income and expenses	営業外損益の部					
Interest income	受取利息	37,255	20,826	34,289	33,075	54,256
Dividend income	受取配当金	163,941	14,889	41,978	13,929	66,434
Other nonoperating income	その他の営業外収益	79,013	50,764	57,819	78,625	108,403
Nonoperating income	営業外収益	280,210	86,480	134,087	125,629	229,094
Interest expenses	支払利息	9,194	4,588	1,300	-	-
Loss on sales of marketable securities	有価証券売却損	-	32,369	-	-	-
Other nonoperating expenses	その他の営業外費用	3,288	13,451	27,854	81,535	3,117
Nonoperating expenses	営業外費用	12,482	50,409	29,155	81,535	3,117
Ordinary income	経常利益	4,497,729	745,721	2,252,165	2,802,730	3,484,275
Extraordinary items	特別損益の部					
Proceeds from sales of fixed assets	固定資産売却益	-	-	-	30,469	-
Damage compensations	損害補償金収入	-	-	-	-	32,031
Allowance for doubtful receivables	貸倒引当金戻入額	38,400	12,400	-	-	-
Received subsidy	受取補助金	311,400	-	-	-	-
Proceeds from sales of investment securities	投資有価証券売却益	-	-	-	133,248	-
Other extraordinary income	その他の特別利益	47,400	-	8,285	5,682	12,196
Extraordinary income	特別利益	397,200	12,400	8,285	169,399	44,227
Loss on disposal of fixed assets	固定資産除売却損	196,653	33,189	56,115	46,196	27,681
Loss from flood damage	水害損失	297,479	-	-	-	-
Loss on revaluation of investment securities	投資有価証券評価損	-	567,687	95,171	-	-
Impairment loss	減損損失	-	-	-	-	412,373
Other extraordinary losses	その他の特別損失	158,841	11,082	119,552	12,086	70,584
Extraordinary losses	特別損失	652,973	611,959	270,838	58,282	510,638
Net income before tax	税引前当期純利益	4,241,955	146,162	1,989,612	2,913,848	3,017,865
Corporate, local income and enterprise taxes	法人税、住民税及び事業税	1,778,161	63,478	1,197,442	736,966	1,310,721
Income tax and other adjustments	法人税等調整額	(52,848)	(32,972)	(413,747)	389,561	(65,302)
Net income	当期純利益	2,516,642	115,656	1,205,918	1,787,320	1,772,446
Retained earnings brought forward	前期繰越利益	467,598	1,276,666	395,734	1,100,182	2,370,432
Treasury stock purchased and retired	利益による自己株式消却額	-	535,372	-	-	-
Interim dividends paid	中間配当額	195,030	230,979	225,744	240,760	234,739
Provision for legal reserve	中間配当に伴う利益準備金積立額	19,503	-	-	-	-
Unappropriated retained earnings	当期末処分利益	2,769,707	625,971	1,375,907	2,646,741	3,908,139

## STOCK INFORMATION 株式情報

### Common Stock Issues 発行済株式の推移

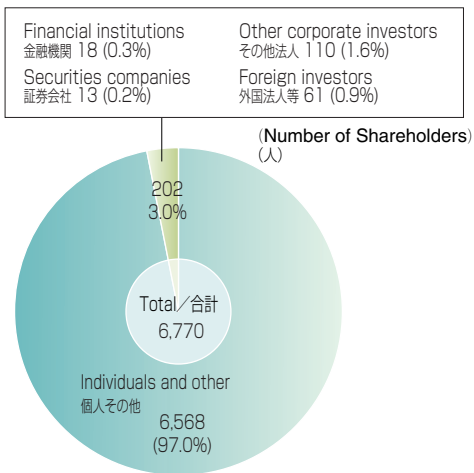
		Type of issue 摘要		Increase (decrease) in shares issued 株式増減数 (株)	Shares outstanding after issue 発行済株式数 (株)	Share capital after issue (Thousands of yen) 資本金 (千円)
February 1, 1992	平成4年2月1日	Allotment of new shares to third parties	第三者割当増資	31,000	245,877	892,438
November 20, 1992	平成4年11月20日	2-for-1 stock split	1株につき2株の株式分割(無償)	245,877	491,754	892,438
September 27, 1993	平成5年9月27日	Exercise of warrants	新株引受権の権利行使	18,000	509,754	1,117,438
May 20, 1994	平成6年5月20日	2-for-1 stock split	1株につき2株の株式分割(無償)	509,754	1,019,508	1,117,438
August 4, 1994	平成6年8月4日	Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	500円額面株式1株を 50円額面株式10株に分割	—	10,195,080	1,117,438
April 18, 1995	平成7年4月18日	Public offering of common stock	一般公募増資	800,000	10,995,080	2,557,438
May 20, 1996	平成8年5月20日	1.1-for-1 stock split	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1,099,508	12,094,588	2,557,438
October 1, 1996	平成8年10月1日	Public offering of common stock	一般公募増資	800,000	12,894,588	4,753,438
May 20, 1997	平成9年5月20日	1.1-for-1 stock split	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1,289,458	14,184,046	4,753,438
May 20, 1998	平成10年5月20日	1.1-for-1 stock split	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1,418,404	15,602,450	4,753,438
November 22, 2001	平成13年11月22日	Treasury stock purchased and retired	自己株式の利益消却	(252,700)	15,349,750	4,753,438
May 20, 2005	平成17年5月20日	2-for-1 stock split	1株につき2株の株式分割	15,349,750	30,699,500	4,753,438

Leading Shareholders (as of March 31, 2005) 大株主一覧 (平成17年3月31日現在)

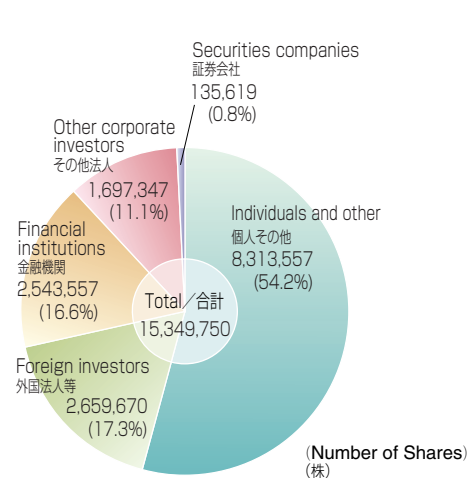
Name of shareholder 株主名		Number of shares owned 所有株式数 (株)	Percentage of total 持株比率 (%)
Isamu Koshiyama	越山 勇	1,651,155	10.8
Sumitaka Noda	野田 純孝	1,420,000	9.3
Koma Co., Ltd.	有限会社コマ	819,180	5.3
Fujimi Incorporated	株式会社フジミンコーポレーテッド	668,279	4.4
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	586,200	3.8
Akira Koshiyama	越山 彰	570,700	3.7
The Chase Manhattan Bank, N. A., London	ザチースマンハッタンバンク エヌエイロンドン	451,100	2.9
Nippon Life Insurance Co.	日本生命保険相互会社	389,940	2.5
State Street Bank and Trust Company 505103	ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー-505103	372,749	2.4
Resona Bank, Ltd.	株式会社りそな銀行	345,892	2.3

Composition of Shareholders by Category (as of March 31, 2005)

所有者別分布状況 (平成17年3月31日現在)



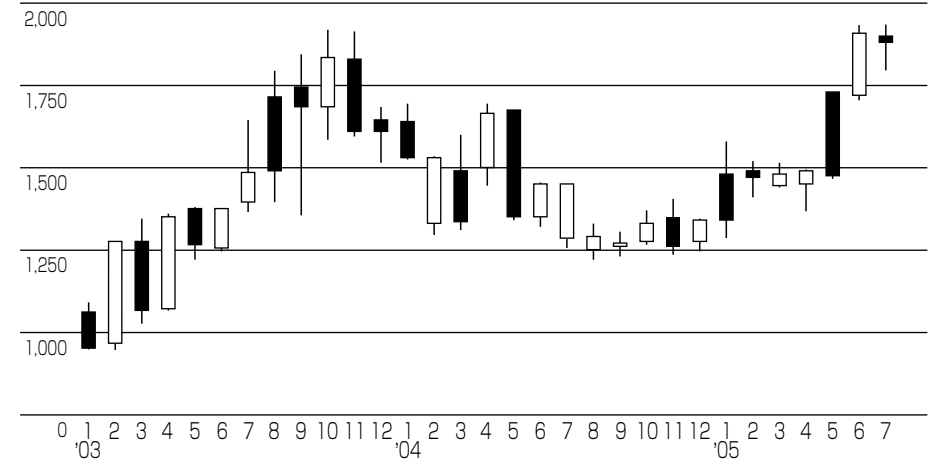
Shareholders by category  
所有者別株主数



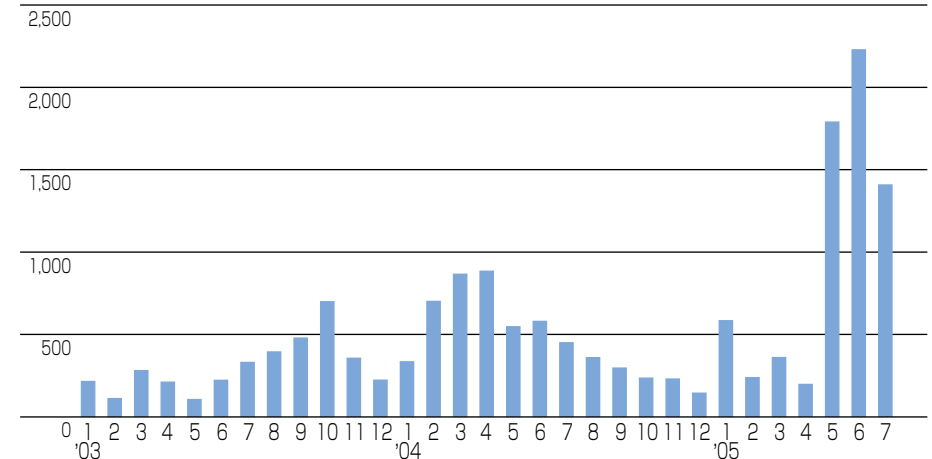
Shares held by shareholder type  
所有者別持株数

Stock Price and Trading Volume 株価および売買高の推移

Stock price (Yen) 株価(円)



Trading volume (Thousands of shares) 売買高(千株)



Notes: 1. Share values have been retroactively adjusted for stock splits in previous years.

2. On March 31, 2005, we implemented a 2-for-1 stock split.

注: 1. 株価データは、株式分割を過年度に遡及して調整した修正株価を使用しています。

2. 平成17年(2005年)3月31日を基準として1株につき2株の割合をもって株式分割を実施しています。

Name 商号	FUJIMI INCORPORATED 株式会社フジミインコーポレーテッド
Date of foundation 設立年月日	March 20, 1953 昭和28年3月20日
Paid-in capital 資本金	¥4,753,438,500
Securities traded 上場市場	JASDAQ, code #5384 ジャスダック市場 証券コード 5384
Number of employees (as of March 31, 2005) 従業員数(平成17年3月31日現在)	357 (nonconsolidated) (単体)

### Board of Directors (as of March 31, 2005) 役員 (平成17年3月31日現在)

President	代表取締役社長	Akira Koshiyama	越山 彰
Managing Director	常務取締役	Tadashi Nagatoshi	永利 正
Director	取締役	Masaaki Kubo	久保 昌昭
Director	取締役	Hitoshi Kodama	児玉 一志
Director	取締役	Hiroyuki Nakagawa	中川 博行
Director	取締役	Nobuo Matsushima	松島 伸男
Director	取締役	Keishi Seki	関 敬史
Standing Corporate Auditor	常勤監査役	Toshiyuki Fujimoto	藤本 俊之
Standing Corporate Auditor	常勤監査役	Sumitaka Noda	野田 純孝
Corporate Auditor	監査役	Tashun Aizawa	鮎澤 多俊
Corporate Auditor	監査役	Norio Yamashita	山下 紀雄

Headquarters 本社	1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japan 〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 Phone: 81-52-503-8181 Fax: 81-52-503-6166
Inazawa Plant 稲沢工場	1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi, 492-8329 Japan 〒492-8329 愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1
Kakamigahara Plant 各務原工場	1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu, 504-0927 Japan 〒504-0927 岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
Kakamihigashimachi Plant 各務東町工場	62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu, 509-0103 Japan 〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
No.2 Kakamihigashimachi Plant 各務東町工場第二棟	82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu, 509-0103 Japan 〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
R&D Center 研究開発センター	179-39, Sue-cho-4, Kakamigahara, Gifu, 509-0108 Japan 〒509-0108 岐阜県各務原市須衛町 4-179-39
Logistics Center 物流センター	603, Sue-cho-2, Kakamigahara, Gifu, 509-0108 Japan 〒509-0108 岐阜県各務原市須衛町 2-603
Tokyo office 東京営業所	1-5, Nihonbashi Muromachi-4, Chuo-ku, Tokyo, 103-0022 Japan 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-1-5 共同ビル7F
Consolidated subsidiaries 連結子会社	<b>FUJIMI CORPORATION</b> 11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A. Phone: 1-503-682-7822 Fax: 1-503-612-9721
	<b>FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.</b> Unit 3, Level 23, Menara Genesis No. 33, Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia Phone: 60-3-2143-0036 Fax: 60-3-2145-8955
	<b>FUJIMI EUROPE LIMITED</b> The Granary, Wolvey Lodge Business Centre, Cloudesley Bush Lane, Wolvey, Hinckley, Leicestershire, LE10 3HB, England Phone: 44-1455-222090 Fax: 44-1455-222099
	<b>FUJIMI EUROPE GMBH</b> Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany Phone: 49-7940-58402 Fax: 49-7940-57611



FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

1-1, Chiryo-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu,  
Aichi, 452-8502 Japan

〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1

Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166

URL: <http://www.fujimiinc.co.jp>



This booklet is printed on 100% recycled paper with soy bean oil-based ink approved by American Soybean Association.

このビジネスレポートは、古紙配合率100%再生紙とアメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

Printed in Japan